

股票简称：好上好

股票代码：001298

深圳市好上好信息科技股份有限公司


好上好信息
— BoBinfo —

向特定对象发行
A 股股票募集说明书
(修订稿)

保荐机构（主承销商）



（注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）

二〇二六年六月

声明

公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书“第六节 与本次发行相关的风险因素”全文，并特别注意以下重大事项或风险：

一、产品代理授权被取消或不能续约的风险

原厂的授权是电子元器件分销商稳健发展的基石，电子元器件分销商的市场拓展是原厂延伸销售的重要途径。公司拥有联发科(MTK)、星宸科技(Sigmastar)、移远(Quectel)、达发(Airoha)、德明利、格科微(Galaxycore)、江波龙(Longsys)、恒玄科技(BES)、PI(帕沃英蒂格盛)、Nordic(北欧半导体)、Cirrus Logic(凌云半导体)、圣邦微(SGMC)、矽力杰(Silergy)、兆易创新(GD)等为代表的一系列全球及国内半导体行业知名原厂分销授权，稳定交易的产品线数量超过100条。如果未来因原厂自身业务调整、公司的服务支持能力无法满足原厂的要求，或是公司与原厂出现争议或纠纷等原因导致公司无法持续取得新增产品线授权或已有产品线授权被取消，这将对公司的业务经营造成重大不利影响。

二、供应商集中的风险

公司电子元器件分销业务采购产品为电子元器件。报告期各期，公司向前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为64.07%、54.90%和47.66%，前五大供应商采购金额占比较高。如果公司前五大供应商的经营状况、产品质量出现问题，或公司与前五大供应商的合作关系发生不利变化，前五大供应商不能向公司持续供应电子元器件产品，则可能对公司的电子元器件分销业务以及经营业绩产生重大不利影响。

三、上下游合作模式变化风险

经过多年的行业演变，原厂、电子元器件分销商、电子产品制造商三者形成了共生关系。一方面，对于下游电子产品制造商而言，电子元器件集成度越来越高，如果其针对每一款电子元器件均直接进行应用端的研发，则将带来高昂的研发成本，但若其在原厂或电子元器件分销商提供的技术方案的基础上进一步研发，则能降低研发投入，并能缩短项目研发周期。另一方面，对于原厂而言，其优势

在于电子元器件的设计与开发,除少量大型客户外,其余客户的开发、维护更多依赖于分销商以降低成本。此外,对于分销商而言,其同时代理大量产品线,具备对单一客户提供多品类产品的能力,其单位服务成本较低。

未来,如果原厂扩大直接服务下游电子产品制造商的范围、原厂与主要客户选择其他分销商替代发行人的角色、主要客户引入替代产品及供应渠道或出现其他导致上下游合作模式发生不利于分销商的变化情况,则作为电子元器件分销商,公司现有分销业务及经营业绩将受到重大不利影响。

四、宏观经济波动风险

电子元器件是电子工业与信息设备的核心基础,公司主要向消费电子、汽车电子、工业控制、新能源、机器人和通讯及数据中心等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件。若未来国内外宏观经济环境恶化,相关行业需求下降,将可能会导致公司出现客户需求下降、电子元器件库存上升、资金压力加大等情况,从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。

五、行业竞争加剧的风险

目前,国内电子元器件分销行业市场集中度较低,处于相对分散的市场格局,价格竞争可能导致行业整体利润空间承压;受限于资金、人员、资源以及海外分销商强势竞争等因素,国内分销商规模相对较小,抗风险能力相对较弱。公司面临国内外同行业企业的激烈竞争,如果公司无法有效提升自身竞争实力,以巩固公司在行业中的优势竞争地位,可能导致公司面临市场占有率降低,盈利能力下降的风险。

六、经营活动现金流量为负的风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,815.91万元、-37,979.07万元和-39,590.25万元,报告期内连续为负数。在公司的电子元器件分销业务中,供应商的货款账期短于客户的货款账期,公司对供应商的付款早于公司对客户的收款,付款与收款之间存在时间差异,同时在公司电子元器件分销业务规模扩大的过程中,容易出现资金缺口,导致经营活动产生的现金流量净额为负数的情形。如果未来公司与客户、供应商之间的信用政策发生重大不利变化,

或者公司的融资渠道发生重大不利变化,则可能导致公司的现金流出现风险,进而影响公司的持续经营能力。

七、存货减值风险

考虑到上游原厂电子元器件的生产供应周期往往与下游客户的生产需求周期不匹配,公司需提前向原厂采购、备货并进行库存管理,导致公司存货规模较大,2023-2025年末,公司存货账面价值分别为61,374.15万元、59,265.42万元和77,812.62万元,占同期末资产总额的比列分别为23.08%、21.21%和19.53%。如果未来出现公司未能及时应对上下游行业供需变化或其他难以预料的原因导致存货无法顺利实现销售,且存货价值低于可变现净值,则该部分存货需要计提存货跌价准备甚至最终出现大额损失,这将对公司经营业绩产生重大不利影响。

八、应收账款回收风险

随着公司未来对市场的进一步开拓及销售规模的扩大,公司的应收账款金额及应收账款占总资产的比例可能将有所增长,2023-2025年末,公司应收账款账面价值分别为104,148.67万元、156,160.95万元和220,241.47万元,占同期末资产总额的比列分别为39.16%、55.87%和55.29%。应收账款的增长可能导致公司应收账款坏账准备计提金额增加,从而对公司经营业绩产生不利影响。此外,如果公司出现大量应收账款无法收回的情况,也将对公司经营业绩及现金流造成重大不利影响。

九、预付款项金额持续上升的风险

2023年末、2024年末及2025年末,公司预付款项余额分别为3,826.22万元、10,655.04万元和15,406.37万元,呈持续上升趋势,主要系报告期内公司经营规模持续扩大,预付采购货款随之相应扩大所致。若未来公司主要预付款项对应的供应商若出现经营恶化、资金链断裂、停产、破产、失信、涉诉被执行等情形,可能导致无法供货、延迟供货、交付质量不达标,预付款项难以收回,从而对公司经营业绩产生不利影响。

十、汇率波动风险

公司在日常经营活动过程中涉及的外汇收支业务主要包括香港子公司向原

厂支付美元计价的产品采购款、香港子公司向客户收取以美元计价的产品销售款和香港子公司向内地子公司收取以人民币计价的产品销售款,香港子公司以港币作为记账本位币,容易受到美元对港币以及人民币对港币汇率波动的影响。若未来美元对港币和人民币对港币汇率波动较大,则公司可能会产生汇兑损失,进而导致公司利润下滑,这将会对公司经营业绩造成不利影响。

十一、国际贸易纷争风险

公司从境外采购的电子元器件产品的金额占公司电子元器件采购总额的比例较高,近年来,由于国际贸易环境的恶化,相关国家挑起了与中国的贸易纷争,该等贸易纷争对公司的正常生产经营活动造成了一定的负面影响。若未来相关贸易纷争加剧,则公司可能面临无法或者无法以合理价格从相关国家和地区进口元器件的风险,从而对公司的生产经营带来严重的负面影响。

十二、募集资金投资项目实施效果偏离预期的风险

公司本次募集资金主要用于“智能仓储物流中心项目”,该项目的实施将提升公司仓储物流环节的智能化水平,优化公司供应链效率,从而增强公司的核心竞争力。若届时市场需求出现较大不利变化,或因管理经验不足导致公司不能充分发挥仓储物流优势,则可能导致公司面临募集资金投资项目实施效果偏离预期的风险。

目 录

声明	1
重大事项提示	2
一、产品代理授权被取消或不能续约的风险	2
二、供应商集中的风险	2
三、上下游合作模式变化风险	2
四、宏观经济波动风险	3
五、行业竞争加剧的风险	3
六、经营活动现金流量为负的风险	3
七、存货减值风险	4
八、应收账款回收风险	4
九、预付款项金额持续上升的风险	4
十、汇率波动风险	4
十一、国际贸易纷争风险	5
十二、募集资金投资项目实施效果偏离预期的风险	5
目 录	6
释义	10
一、普通术语	10
二、专业术语	12
第一节 发行人基本情况	15
一、公司基本信息	15
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况	15
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况	16
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容	42
五、发行人主要固定资产及无形资产情况	58
六、现有业务发展安排及未来发展战略	84
七、截至最近一期末，不存在金额较大的财务性投资的基本情况	86
八、最近一期利润下滑的情况	87
九、报告期内交易所对发行人年度报告的问询情况	87

第二节 本次证券发行概要	89
一、本次发行的背景和目的	89
二、发行对象及与发行人的关系	91
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期	92
四、募集资金金额及投向	93
五、本次发行是否构成关联交易	94
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化	94
七、本次发行取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	94
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	96
一、募集资金投资项目概览	96
二、项目实施的基本情况	96
三、项目经济效益分析	104
四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式	104
五、关于两符合	106
六、募集资金用于研发投入的情况	108
七、募集资金投向产生的同业竞争及关联交易	108
八、募投项目实施后对公司经营的影响	108
九、募集资金专项管理制度	109
十、募投项目新增固定资产及无形资产的影响	109
第四节 最近五年内募集资金运用的基本情况	110
一、前次募集资金基本情况	110
二、前次募集资金的实际使用情况	111
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况	117
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况	118
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照	118
六、会计师对前次募集资金使用情况的鉴证结论	118
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	119
一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划	119
二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化	119

三、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况	119
四、本次发行完成后,上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况	119
第六节 与本次发行相关的风险因素	120
一、产品代理授权被取消或不能续约的风险	120
二、供应商集中的风险	120
三、上下游合作模式变化风险	120
四、宏观经济波动风险	121
五、行业竞争加剧的风险	121
六、新产品推广、开发风险	121
七、核心人员流失、核心技术泄漏风险	121
八、电子元器件分销业务毛利率变动的风险	122
九、经营活动现金流量为负的风险	122
十、存货减值风险	122
十一、应收账款回收风险	123
十二、预付款项金额持续上升的风险	123
十三、汇率波动风险	123
十四、国际贸易纷争风险	123
十五、审批风险	124
十六、募集资金无法募足的风险	124
十七、募集资金投资项目实施效果偏离预期的风险	124
十八、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险	124
十九、经营管理风险	124
二十、股价波动风险	125
二十一、净资产收益率和每股收益摊薄的风险	125
第七节 与本次发行相关的声明	126
发行人及全体董事、高级管理人员声明	126
董事会审计委员会声明	130
发行人控股股东声明	133

发行人实际控制人声明	134
保荐人（主承销商）声明	135
保荐人（主承销商）董事长、总经理声明	136
发行人律师声明	137
会计师事务所声明	138
发行人董事会声明	139

释义

除非另有说明，本募集说明书中的下列词语或简称具有如下含义：

一、普通术语

好上好、发行人、公司	指	深圳市好上好信息科技股份有限公司
募集说明书	指	深圳市好上好信息科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书
本次发行、本次向特定对象发行、向特定对象发行	指	好上好向不超过 35 名特定对象发行 A 股股票募集资金的行为
热点投资	指	香港地区公司，热点投资有限公司/HOTPOINT INVESTMENT LIMITED，发行人控股股东
深圳北高智	指	深圳市北高智电子有限公司，发行人全资子公司
深圳天午	指	深圳市天午科技有限公司，发行人全资子公司
深圳大豆	指	深圳市大豆电子有限公司，发行人全资子公司
深圳蜜连	指	深圳市蜜连科技有限公司（曾用名：上海蜜连科技有限公司），发行人全资子公司
深圳泰舸	指	深圳市泰舸微电子有限公司，发行人全资子公司
前海北高智	指	北高智科技（深圳）有限公司，发行人全资子公司
香港北高智	指	香港地区公司，香港北高智科技有限公司/HONG KONG HONESTAR TECHNOLOGY CO., LIMITED，发行人全资子公司
香港天午	指	香港地区公司，天午科技有限公司/SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED，发行人全资子公司
香港蜜连	指	香港地区公司，蜜连科技有限公司/Ibeelink Technology Co., Limited（曾用名：大豆科技有限公司/DADOUTEK COMPANY LIMITED），发行人全资子公司
北高智	指	中国台湾地区公司，北高智科技有限公司，发行人全资子公司
宝汇芯微	指	深圳市宝汇芯微电子有限公司，发行人控股子公司
无锡有容	指	无锡有容微电子有限公司，公司参股的企业
交易中心	指	电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司，发行人全资子公司的参股公司
小米集团	指	包含 XIAOMI H.K. LIMITED、北京小米电子产品有限公司、小米通讯技术有限公司、江苏紫米电子技术有限公司、北京玄戒技术有限公司、上海玄戒技术有限公司，发行人主要客户
康冠科技	指	包含惠州市康冠科技有限公司、惠州市康冠汽车电子有限公司、深圳市皓丽软件有限公司、深圳市康冠科技股份有限公司、深圳市康冠商用科技有限公司、深圳市康冠智能科技有限公司、香港康冠技术有限公司、深圳市福比特智能科技有限公司，发行人主要客户
兆驰股份	指	包含深圳市兆驰股份有限公司、深圳市兆驰数码科技股份

		有限公司、深圳市兆驰光元科技有限公司，发行人主要客户
华曦达	指	包含华曦达科技（香港）有限公司、深圳市华曦达科技股份有限公司，发行人主要客户
大疆科技	指	包含深圳市大疆百旺科技有限公司、深圳市大疆如影科技有限公司，发行人主要客户
龙旗科技	指	包含龙旗通信技术（香港）有限公司、龙旗电子（惠州）有限公司、南昌龙旗信息技术有限公司，发行人主要客户
华勤技术	指	包含东莞华贝电子科技有限公司、华勤通讯香港有限公司、华勤技术股份有限公司，发行人主要客户
锐明技术	指	包含深圳市锐明技术股份有限公司、锐明科技（东莞）有限公司、锐明智造（越南）有限公司，发行人主要客户
移远通信（Quectel）	指	包含上海移远通信技术股份有限公司、常州移远通信技术股份有限公司、香港移远通信技术有限公司/QUECTEL WIRELESS SOLUTIONS HK CO., LIMITED、QUECTEL IOT TECHNOLOGIES PTE. LTD.，发行人主要客户；合肥移瑞通信技术有限公司、上海安科联科技有限公司、上海移远通信技术股份有限公司，发行人主要供应商
联发科（MTK）	指	包含联发科技股份有限公司/MediaTek Inc.、MediaTek Inc. Taipei Branch、MediaTek Singapore Pte. Ltd.、达发科技股份有限公司/Airoha Technology Corp.，发行人主要供应商
恒玄科技（BES）	指	Bestechnic, limited、恒玄科技（上海）股份有限公司，发行人主要供应商
达发科技（Airoha）	指	达发科技股份有限公司/Airoha Technology Corp.，发行人主要供应商
升特半导体（Semtech）	指	Semtech（International）AG，发行人供应商
星辰科技（Sigmastar）	指	包含星辰科技股份有限公司/SigmaStar Technology Ltd.、星辰微电子（深圳）有限公司、厦门星觉科技有限公司，发行人主要供应商
晶晨半导体（Amlogic）	指	包含晶晨香港有限公司/Amlogic Co., Limited、晶晨半导体（深圳）有限公司、晶晨半导体（上海）股份有限公司、锐宸微（上海）科技有限公司，发行人主要供应商
MPS（芯源系统）	指	MPS Schaffhausen International GmbH，发行人供应商
江波龙（Longsys）	指	包含江波龙电子（香港）有限公司/LONGSYS ELECTRONICS（HK）CO., LTD、深圳市江波龙电子股份有限公司，发行人供应商
德明利（TWSC）	指	包含源德（香港）有限公司/REALTECH SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED、深圳市德明利技术股份有限公司，发行人供应商
Renesas（瑞萨电子）	指	包含 Renesas Design Germany GmbH、RENASAS ELECTRONICS（PENANG）SDN.BHD.、Renesas Electronics Corporation、Renesas Electronics Operations Services Limited、WT MICROELECTRONICS（HONG KONG）LIMITED、瑞萨电子香港有限公司 RENASAS ELECTRONICS HONG KONG LIMITED，发行人供应商
PI（帕沃英蒂格盛）	指	Power Integrations International, Ltd.，发行人主要供应商
圣邦股份（SGMC）	指	包含圣邦微电子（香港）有限公司/SG Micro（HK）Limited、圣邦微电子（北京）股份有限公司/SG Micro Corp.，发行人主要供应商

CreeLED（格立）	指	包含 Cree Venture LED Company Limited、CREE LED HONG KONG LIMITED、格立电子科技（上海）有限公司，发行人主要供应商
Nordic（北欧半导体）	指	包含 Nordic Semiconductor、Nordic Semiconductor Singapore Pte Ltd，发行人主要供应商
博泰科技	指	博泰车联网科技（上海）股份有限公司，发行人主要客户
保荐人、主承销商、国信证券	指	国信证券股份有限公司
发行人律师、中伦律所	指	北京市中伦律师事务所
发行人会计师、司农会计师	指	广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
天职会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳市好上好信息科技股份有限公司章程》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》	指	《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工信部、工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
SIA	指	Semiconductor Industry Association，美国半导体行业协会，为美国及全球半导体产业提供服务，包括统计研判行业景气度、发布权威产销数据、开展产业政策倡导与行业协同规范
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计组织，为世界半导体行业提供服务，包括收集并发布半导体行业数据
A 股	指	每股面值为 1.00 元之人民币普通股
报告期/最近三年	指	2023 年、2024 年及 2025 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

二、专业术语

电子元器件	指	广义的半导体、电子元器件产品，包括集成电路芯片和其他电子元器件产品
半导体	指	常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料
半导体器件	指	利用半导体材料特殊电特性完成特定功能的电子器件
IC/芯片	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种微型电子器件或部件，通过一定的工艺把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连在一起，制作在一小块或几小块半

		导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构
主动元器件	指	需要能（电）源的器件叫主动元器件，能控制电压或电流，或在电路中创造转换的动作，也称为有源器件。主动元器件一般用来信号放大、变换等。如：IC、模块等都是有源器件
被动元器件	指	无需能（电）源的器件就是被动元器件，其不实施控制，并不要求任何输入器件就可完成自身的功能，也称为无源器件。无源器件用来进行信号传输，或者通过方向性进行“信号放大”。如：电容、电阻、电感等都是无源器件
模组/模块	指	集成某些特定功能的芯片和基本电路的集合，具有标准接口的电子产品。如蓝牙模块、WiFi 模块等
SoC	指	System on Chip 的缩写，即芯片级系统，也称片上系统，是将微处理器、模拟 IP 核、数字 IP 核和存储器（或片外存储控制接口）集成在单一芯片上，形成一体化的控制器，主要应用在系统集成度要求高、可靠性高、时延要求低、系统板空间比较小的领域
MCU	指	Micro Controller Unit 的缩写，即微控制单元，也称单片机，是把中央处理器的频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB 等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中，形成芯片级的计算机
LED	指	即 LED 发光二极管，是一种固态的半导体器件，利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、白等颜色的光
存储器	指	用来存储程序和各种数据信息的记忆部件，是许多存储单元的集合
TWS	指	True Wireless Stereo 的缩写，即真正无线立体声
LoRa	指	Long Range Radio 的缩写，是一种基于扩频技术的低功耗远距离无线传输技术
WiFi	指	Wireless-Fidelity 的缩写，是一种基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术
BLE	指	Bluetooth Low Energy 的缩写，一种基于 802.15.4 标准的无线局域网技术
Zigbee	指	一种基于 802.15.4 标准的无线局域网技术
NB-IoT	指	Narrow Band Internet of Things 的缩写，是指窄带物联网技术
DTU	指	Data Transfer Unit 的缩写，无线数据通讯传输单元
USB	指	Universal Serial Bus 的缩写，通用串行总线
Cortex	指	ARM 公司一个系列处理器的名称
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源规划，是对企业资源进行有效管理、共享与利用的系统
AE	指	Application Engineer，应用开发工程师
FAE	指	Field Application Engineer，现场支持工程师
Fabless	指	Fabrication 和 Less 的组合，是指没有制造业务、只专注于设计的一种运作模式。Fabless 公司负责芯片的电路设计与销售，将生产、测试、封装等环节外包。也指未拥有芯片制造工厂的 IC 设计公司，经常被简称为“无晶圆厂”（晶圆是芯片/硅集成电路的基础，无晶圆即代表无芯片制造）；通常说的 IC design house（IC 设计公司）即为 Fabless

外围电路	指	主芯片周边的辅助电路，为实现主芯片各脚位功能，使用模拟器件、数字器件等各种辅助电子元器件搭建的电路
原厂	指	电子元器件设计制造商，公司上游供应商
电子产品制造商	指	电子产品部件制造商、终端电子产品制造商及电子代工企业之统称，公司下游客户
代理商、授权分销商	指	具有原厂分销授权资质的分销商，采取与上游原厂签订代理协议的方式获得分销授权，与原厂合作紧密，并能获得原厂在信息、技术、供货等方面的直接支持

注：本募集说明书除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入所致。

第一节 发行人基本情况

一、公司基本信息

公司名称	深圳市好上好信息科技股份有限公司
英文名称	Shenzhen Best of Best Holdings Co., Ltd.
股票简称	好上好
股票代码	001298.SZ
统一社会信用代码	91440300321699270K
法定代表人	王玉成
成立日期	2014年12月23日
注册资本	43,251.4027万元
上市时间	2022年10月31日
上市地点	深圳证券交易所
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5109号前海卓越金融中心(一期)8号楼1506A
办公地址	广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1503
董事会秘书	王丽春
经营范围	计算机软硬件、智能网络、大数据、物联网、消费电子及其相关产品的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务;以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务;电子元器件的批发、零售(不涉及外商投资准入特别管理措施)、进出口相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品,按国家有关规定办理申请后经营)。

二、股权结构、控股股东及实际控制人情况

(一) 发行人的股权结构

截至2026年5月31日,发行人的总股本和股权结构如下:

股份类别	股份数量(万股)	占总股本比例
一、有限售条件股份	2,509.46	5.80%
1、高管锁定股	2,106.75	4.87%
2、股权激励限售股	402.70	0.93%
二、无限售条件股份	40,741.94	94.20%
三、股份总数	43,251.40	100.00%

(二) 本次发行前前十名股东的持股情况

截至 2026 年 5 月 31 日，发行人的前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数(万股)	持股比例(%)
1	热点投资有限公司	14,322.44	33.11
2	深圳市点通投资管理中心(有限合伙)	3,182.76	7.36
3	王玉成	2,791.90	6.46
4	深圳市前哨投资管理中心(有限合伙)	2,028.09	4.69
5	深圳市聚焦投资管理中心(有限合伙)	1,993.66	4.61
6	深圳市研智创业投资合伙企业(有限合伙)	1,241.02	2.87
7	深圳市持恒创业投资合伙企业(有限合伙)	1,202.25	2.78
8	广发证券股份有限公司—博道成长智航股票型证券投资基金	142.22	0.33
9	香港中央结算有限公司	123.267	0.29
10	招商银行股份有限公司—鹏华启航量化选股混合型发起式证券投资基金	82.8275	0.19
	合计	27,110.44	62.69

(三) 控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署之日，发行人控股股东为热点投资，发行人实际控制人为王玉成、范理南夫妇，王玉成为公司董事长、总经理，范理南为公司董事，二人共同为公司的实际控制人。王玉成先生直接持有公司股份 2,791.90 万股，王玉成先生、范理南女士直接和间接合计持有公司 17,187.00 万股股份，占公司总股本的比例为 39.7375%。王玉成先生为控股股东热点投资有限公司的实际控制人，王玉成先生、范理南女士可以控制的公司的表决权比例为 39.5694%。

发行人控股股东、实际控制人持有的发行人股份不存在质押的情况。

三、所处行业的主要特点及行业竞争情况

(一) 所处行业的主要特点

1、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策

(1) 发行人所处行业

发行人是国内知名的电子元器件分销商，主要向消费电子、汽车电子、工业控制、新能源、机器人和通讯及数据中心等应用领域的电子产品制造商销售电子

元器件，并提供产品方案和技术支持。报告期各期，发行人电子元器件分销业务占主营业务收入比重均在 99%以上。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，发行人所属行业为“批发业”（行业代码 F51）。

(2) 行业主管部门和监管体制

公司处于电子元器件分销行业，该行业主管单位为国家工信部，其主要职责为：（一）提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；（二）制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策；（三）监测分析工业、通信业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；（四）拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施等。

中国半导体行业协会（CSIA）负责行业各成员单位的自律规范和协调规范，其主要任务为：（一）落实政策，开展行业研究，为政府提供发展决策支撑；（二）开展行业数据统计分析，发布市场及运行相关信息；（三）举办行业交流活动，推动产业链上下游合作；（四）开展国际交流合作，助力企业国际化，维护产业利益；（五）为企业提供各类咨询及个性化服务，解决发展难题；（六）协助制定行业标准，推动行业质量与管理水平提升。

中国信息产业商会电子元器件应用与供应链分会（ECAS）是由中国信息产业商会（CIITA）批准成立的全国性电子分销行业自愿参加的社会团体分支机构。其业务范围主要包括：（一）开展电子元器件应用与供应链领域行业调研、数据统计与信息发布，搭建产业链交流合作平台；（二）推动行业自律、规范与标准建设，维护市场秩序；（三）对接产业政策，促进国产替代与供应链安全稳定；（四）组织行业论坛、培训与资源对接，服务会员发展；（五）协助推进电子元器件国际交易中心等产业平台建设，开展国内外产业合作与交流，助力电子元器件分销及供应链行业高质量发展。

(3) 行业主要法律法规和政策

公司所处的电子元器件分销行业主要相关政策如下：

文件名称	发布时间	发布部门	与本行业相关主要内容
《义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》			路国际交易中心，打造电子元器件、集成电路企业和产品市场准入新平台，促进上下游供应链和产业链的集聚融合、集群发展。支持电子元器件和集成电路企业入驻交易中心，鼓励国内外用户通过交易中心采购电子元器件和各类专业化芯片，支持集成电路设计与用户单位通过交易中心开展合作。积极鼓励、引导全球知名基础电子元器件和芯片公司及上下游企业（含各品牌商、分销商或生产商）依托中心开展销售、采购、品牌展示、软体方案研发、应用设计、售后服务、人员培训等。

(4) 上述法律法规和产业政策对公司经营发展的影响

集成电路产业和软件产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。集成电路产品广泛应用于军事、工业、农业、交通、政务、金融、安全、办公、通信、教育、传媒、娱乐等各个领域。

近年来，国务院、发改委、工信部、财政部等部门持续出台一系列政策，对集成电路产业给予长期鼓励与支持，通过财政、税收、补贴等多种方式助力行业高质量发展。芯片作为信息时代的“核心基石”，是国家高端制造与科技竞争力的重要体现，芯片自主可控与国产化已是大势所趋。国内集成电路产业持续蓬勃发展，有力带动电子元器件分销行业快速成长。国家对集成电路产业的持续政策支持，为公司经营发展创造了良好的外部环境。

2、行业概况及发展趋势

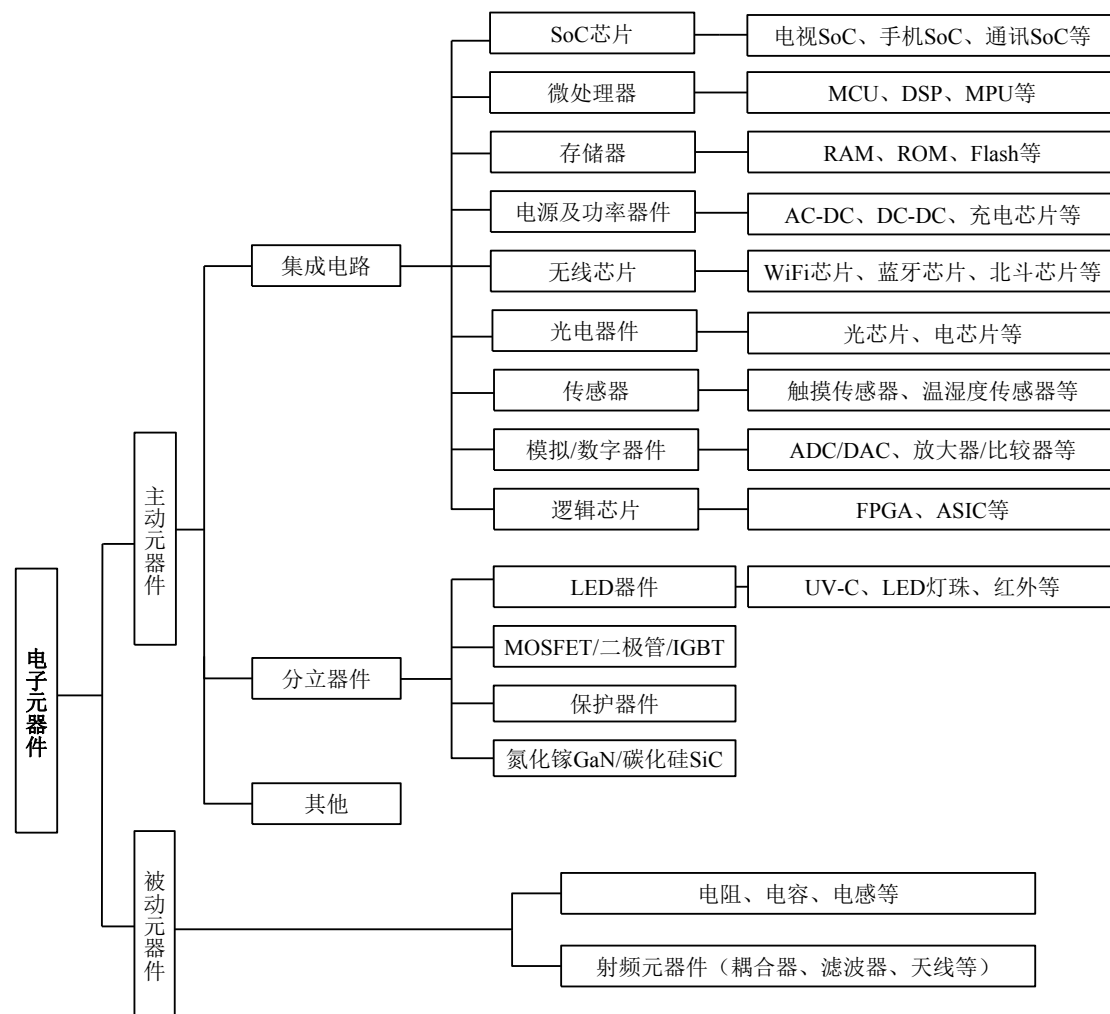
电子元器件分销商是上游的电子元器件设计制造商和下游的电子产品制造商之间的纽带，是电子元器件产业链上的重要一环。分销商为上下游提供产品推广、方案开发、技术支持、交付服务等，在产业链中起到了不可或缺的作用。近年来，上游电子元器件设计制造行业不断推出新工艺、新功能、新产品，下游应用领域市场规模持续增长，国产芯片产业逐渐崛起，将共同促进电子元器件分销行业的发展。

(1) 电子元器件产业链概况

1) 电子元器件分类

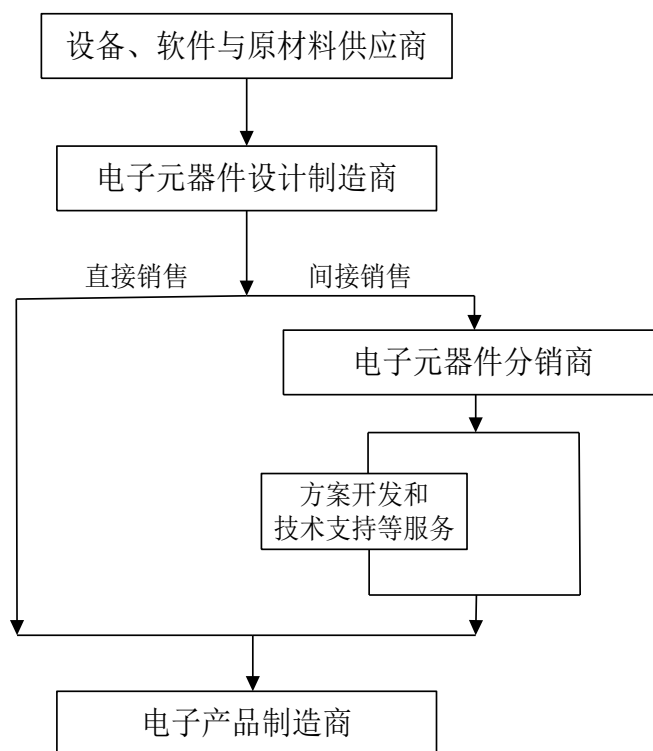
电子元器件包括主动元器件和被动元器件，主动元器件可以进一步细分集成

电路、分立器件等，其中，集成电路可以进一步细分为 SoC 芯片、微处理器、存储器、电源及功率器件、无线芯片、光电器件、传感器、模拟/数字器件、逻辑芯片等，分立器件可以进一步细分为 LED 器件、MOSFET/二极管/IGBT、保护器件、氮化镓 GaN/碳化硅 SiC 等；被动元器件可以进一步细分为电阻、电容、电感、射频元器件等；电子元器件分类的具体情况如下图：



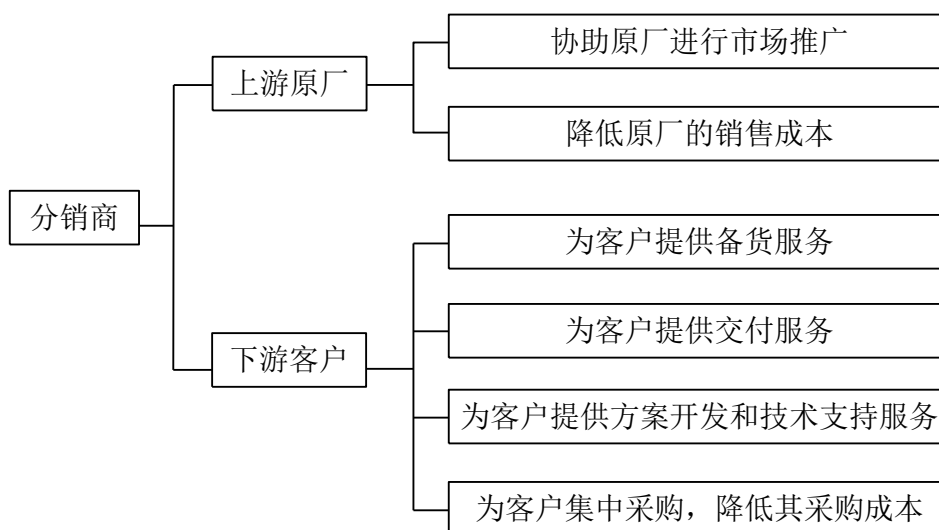
2) 电子元器件产业链

电子元器件产业链中主要包括设备、软件与原材料供应商、电子元器件设计制造商、电子元器件分销商及下游电子产品制造商。电子元器件设计制造商采用直接销售或间接销售的方式向下游电子产品制造商供应产品，其中间接销售主要通过电子元器件分销商进行，在销售过程中，分销商除开展销售业务外，还可以为下游客户提供方案开发和技术支持等服务。电子元器件分销商在产业中的地位如下：



(2) 电子元器件分销商在产业链中的作用

电子元器件分销商是电子元器件产业上下游之间的纽带。一方面，电子元器件分销商可以协助上游原厂进行市场推广，并降低原厂的销售成本；另一方面，电子元器件分销商可以为客户提供备货服务、交付服务、方案开发和技术支持服务，帮助客户集中采购，降低其采购成本。电子元器件分销商在产业链中的作用如下：



1) 电子元器件分销商对上游原厂的作用

①协助原厂进行市场推广

专业的电子元器件分销商具备协助原厂进行新产品市场开拓的能力。由于下游电子产品制造商数量多并且较为分散,原厂直销成本较高,专业的电子元器件分销商拥有数量众多且优质的客户资源,可以协助原厂快速进行产品推广,和原厂合力完成电子元器件产品销售。尤其是对于中小型原厂而言,电子元器件分销商可以利用自身品牌影响力以及多年积累的分销经验,协助中小型原厂进行市场开拓。

②降低原厂的销售成本

电子元器件分销商可以将客户订单信息和客户需求计划信息进行汇集处理,众多终端客户采购的产品统一由电子元器件分销商向原厂采购,降低了原厂的销售订单处理、仓储、物流、管理等成本。同时,对于部分原厂而言,其在国内的销售人员、技术服务人员相对较少,电子元器件分销商开展分销业务在一定程度上降低了原厂的人力成本。

2) 电子元器件分销商对下游客户的作用

①为客户提供备货服务

电子元器件生产周期较长,而客户一般需要及时供货保障。电子元器件分销商可以根据其对市场需求的预测,或根据客户的需求计划,为下游客户提供备货服务,保障客户生产所需电子元器件供应的稳定性和及时性。

②为客户提供交付服务

电子元器件行业相关产业链遍布全球,主要原厂分布在世界各地,电子产品制造商主要分布在亚太地区。电子元器件分销商一般在主要电子元器件集散地均设有经营主体,销售网络覆盖较广,客户可以根据自身生产经营的需要指定收货地点,无须参与复杂的国际物流。另外,大客户一般对于货物标识有严格的需求,电子元器件分销商根据客户需求对交付产品的包装进行多层次的标识,保障货物交付规范、可追溯,满足客户生产与仓储管理要求。

③为客户提供方案开发和技术支持服务

电子元器件分销商面向大量客户提供产品解决方案和技术支持服务,能够就客户需求进行快速响应并提供合适的解决方案。对于大客户而言,专业的电子元

器件分销商拥有丰富的技术、方案储备以及行业同类型产品的解决方案，可以就其提出的需求进行快速响应，为客户提供全方位技术支持，减少客户自身的研发成本；对于技术能力较弱的中小客户来说，电子元器件分销商可以为其提供整体解决方案，即包括需求评估、产品设计、系统调试、设计优化到交付后跟线生产在内的一站式服务，弥补其在技术方面的不足，助力其产品快速落地。

④为客户集中采购，降低其采购成本

电子元器件分销商一般代理较多类别的产品线，可以将不同原厂的多个产品集合向同一客户出售，一次性满足客户的多项产品需求，并可以根据客户对性能、功能、质量以及规格等不同的产品需求，针对性地提供符合要求的电子元器件产品，从而在一定程度上降低客户的采购成本。

(3) 电子元器件分销行业现状及发展趋势

1) 电子元器件分销行业现状

电子元器件分销行业在发展过程中呈现如下现状：

①海外分销商集中度较高，本土分销商集中度仍偏低但整合提速

全球电子元器件分销行业成熟度高，海外头部分销商凭借长期并购整合与全球资源布局，行业集中度保持高位。国内分销行业依托电子制造与半导体产业升级快速扩容，早期因市场空间广阔、准入门槛相对较低，企业数量多、规模分化明显，行业集中度仍偏低。当前本土头部企业通过并购整合、聚焦产品线与技术服务升级加速扩张，叠加供应链自主可控需求驱动，行业整合提速，未来并购重组将更趋活跃，集中度将持续向海外成熟市场水平靠拢。

②分销商仍以代理海外原厂为主，国产元器件分销替代进入加速期

全球电子元器件设计制造领域由欧美日韩原厂主导核心技术与高端产能，本土分销商当前代理的海外原厂产品线数量与营收占比仍较高。近年国产芯片、被动元件、功率器件等在研发、车规认证与批量供货上快速突破，叠加供应链安全与降本需求，国产元器件在分销渠道的渗透率持续提升。本土分销商积极拓展国产原厂资源，面向 AI、汽车电子、工业控制等场景推进国产替代，分销领域国产元器件增长空间与确定性显著增强。

2) 电子元器件分销行业发展趋势

①技术服务能力与信息化数字化水平成为分销商核心竞争力

国内电子产品制造领域广泛、产品迭代迅速，下游客户对技术支持、应用方案的需求日趋复杂。大型电子产品制造商议价能力较强，对多场景技术服务与方案落地能力要求更高，上游原厂需依托具备丰富应用经验的分销商协同服务；中小制造商订单分散、研发资源有限，更依赖技术服务能力突出、产品线齐全的分销商满足发展需求。随着电子制造业向高端化、智能化升级，下游客户更倾向与具备综合技术服务能力的本土分销商深度合作。分销商需持续提升元器件应用方案设计、现场技术支持、定制化解决方案服务能力，同时依托信息化、数字化系统建设，实现询价、报价、仓储、交付、结算、开票等全流程精细化管理，以高效运营支撑技术服务落地。通过技术能力与数字化水平同步提升，分销商不断增强客户粘性与核心竞争力，强化自身不可替代性。

②本土电子元器件分销行业集中度上升

近年来，本土电子元器件分销商资本化进程加快，行业内并购重组日趋活跃，资本驱动的整合效应逐步显现。上市企业通过并购实现业务外延扩张与资源整合，进一步推动行业集中度提升。从并购方向看，以横向整合同业企业、补强产品线与客户渠道、布局汽车电子、工业控制等高增长赛道为主。商络电子、雅创电子、英唐智控等行业内龙头企业均持续推进并购举措，例如商络电子收购立功科技，补强车规级与工业控制芯片资源；雅创电子近年陆续收购欧创芯、怡海能达、类比半导体等，完善“分销+自研芯片”布局；英唐智控拟收购光隆集成、奥简微电子，强化半导体业务协同。

随着电子元器件分销行业逐步成熟，叠加头部企业资金、渠道、原厂资源优势不断强化，未来行业兼并收购将持续增加，市场资源向优势企业集中，行业集中度将稳步提升。

③国产半导体产业快速发展为分销商带来新的业务机遇

在全球半导体产业链重构与供应链安全需求提升的背景下，国内持续加大对半导体产业的支持力度，推动国产芯片与元器件研发、量产与市场应用，提升产业链自主可控水平。

国家出台一系列政策支持集成电路与软件产业高质量发展,在财税、投融资、研发、人才、知识产权等方面构建完善政策体系,鼓励关键核心技术突破,推动产业集聚与创新发展。在政策与市场双重驱动下,国产芯片及电子元器件在品类、质量、可靠性与批量供应能力上持续提升,国产替代空间广阔。本土分销商积极布局国产原厂资源,深度参与国产元器件推广与方案落地,迎来新的业务增长机遇。

3、行业技术水平及特点

电子元器件分销行业并不从事具体产品的生产,其技术水平主要体现在对上下游的技术服务能力,另外,由于分销商是上下游之间的桥梁,服务大量的上游原厂和下游电子产品制造商,日常业务涉及大批量数据的处理,对信息化水平有较高要求,行业技术水平及特点体现为以下两点:

(1) 对上下游的技术服务能力

电子元器件分销行业是电子元器件产业链上下游之间的桥梁,其技术研发工作一般围绕上下游的需求展开。上游电子元器件设计制造行业的技术发展和下游电子产品制造商的技术需求共同促进电子元器件分销行业的技术水平不断进步。

分销商的技术能力主要体现在向下游电子产品制造商提供整体解决方案和现场技术支持,包括产品选型、软硬件应用开发、系统调试等技术服务;软件功能扩展、硬件平台优化等维护服务;开发平台工具使用、软硬件应用中的注意事项等培训服务。加快下游电子产品制造商研发进程,帮助其产品快速落地。

分销商可以向上游电子元器件设计制造商提供产品需求信息,并针对其新产品进行测试、方案设计,开发适合新产品的应用场景,助力其新产品快速推向市场。

(2) 行业内企业的信息化水平

电子元器件销售业务规模大且交易模式多样化,业务涉及大量的订单管理、备货管理、库存管理、物流管理、资金结算等,专业的电子元器件分销商一般具备强大的信息系统,主要包括 ERP 系统、数据分析系统、仓库系统、办公系统等,以处理日常业务中的大批量数据。

4、进入本行业的主要壁垒

(1) 原厂的授权壁垒

原厂的产品线授权是授权分销商开展业务的基础，代理产品线的数量、质量是分销商稳定经营、提升综合竞争力的重要保障。通过原厂的授权，优质电子元器件分销商能够以合理的价格获取具备市场竞争力的产品，并保证供货的稳定，这是电子元器件分销商的核心竞争力之一。一般原厂选择分销商会有严格的标准，双方建立合作关系后一般会长期合作，同一区域分销商的数量相对稳定，后来者获得相关原厂的新增授权的难度较高。

(2) 客户资源壁垒

优质的客户资源可以支撑电子元器件分销商的收入水平，客户的成长可以促进分销商的业绩增长。客户数量多有利于降低细分市场波动对公司整体业绩的影响。为保证稳定的供货渠道和优质的技术服务，下游客户一般偏好选择综合能力较强的电子元器件分销商，并建立严格的合格供应商准入制度，在合作前对供应商进行全方位的考察。另外，由于部分电子元器件分销商可以提供方案支持和技术服务，合作周期越长，客户粘性越强，从而对后来者形成较高的客户认可壁垒。

(3) 存货管理和交付壁垒

由于电子元器件产业是一个全球性的产业，分销商往往需要跨境采购，并在约定的时间内将产品交付到其客户指定的地点，交易的物流管理体系较为复杂，且需要在境内外自建或租借仓库，进行存货的管理和运输，对后来者形成壁垒。

上游原厂的生产和下游电子产品制造商对电子元器件的需求周期存在数周的时间差异，双方均很难对产品需求周期进行准确预测，分销商需要通过科学的需求预测和备货管理，满足下游客户的产品需求，分销商的需求预测和备货管理能力需要长期的经验积累和强大的信息系统的支持。

复杂的物流管理体系、需求预测能力、备货管理能力和信息系统技术水平共同构成的存货管理能力对后来者形成了进入壁垒。

(4) 技术和人才壁垒

一方面，电子产品制造商面临的市场环境日趋复杂，对其产品的更新迭代速度提出了更高的要求，因此下游电子产品制造商希望分销商能提供产品方案和技术支持，缩短其产品研发周期，并及时解决研发和生产过程中遇到的技术问题。另一方面，上游原厂希望分销商能参与其新产品的测试、产品应用场景开发，与原厂共同进行新产品的市场推广。产品方案、技术支持、新产品的测试及应用场景的开发均离不开长期的技术积累和成熟的人才队伍，这对后来者形成了技术和人才壁垒。

(5) 资金壁垒

电子元器件分销商通常采用买断式经营模式，分销商向上游原厂采购一般没有信用期或者信用期较短，下游客户却需要较长的信用期，采购和销售信用期的不匹配，使得分销商存在较大的营运资金需求，后来者进入分销领域将面临资金规模和资金成本的壁垒。

5、影响行业发展的有利和不利因素

(1) 影响行业发展的有利因素

1) 国家产业政策的大力支持

信息技术产业是关系国民经济安全和发展的战略性、基础性、先导性产业，也是世界主要国家高度重视、全力布局的竞争高地。电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链、供应链安全稳定的关键。近年来，国务院、发改委、工信部、财政部等国家部委发布了一系列电子元器件行业发展的政策，支持电子元器件行业的快速发展。具体情况详见本募集说明书“第二节 本次证券发行概要”之“一、本次发行的背景和目的”之“（一）本次向特定对象发行股票的背景”之“1、国家产业政策持续赋能，支持半导体产业链高质量发展”相关内容。

电子元器件产业规模的不断壮大给分销商提供了发展空间，技术创新取得突破可以为分销行业提供更多的优质产品线，将促进本土电子元器件分销行业快速成长，提高本土电子元器件分销商的市场竞争力。

2) 半导体产业快速发展的带动

电子元器件分销行业作为上游设计及制造厂商和下游电子产品制造商的重要桥梁，全球和中国半导体产业的快速发展将带动分销行业的较快发展。

全球半导体行业近年来呈现周期性波动态势。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）统计，2022年全球半导体销售额达到5,741亿美元，创历史新高；受通货膨胀、地缘贸易摩擦等因素影响，市场从年中开始进入周期性下滑阶段；2023年全球半导体市场低迷，全年销售额为5,268亿美元，同比下滑8.2%；2024年全球半导体市场迎来强劲复苏，全年销售额达6,305亿美元，同比增长19.7%，其中存储器板块表现突出，AI相关半导体需求成为主要增长动力；2025年，全球半导体市场在AI算力需求的持续爆发下，延续高速增长并再创新高，全年销售额达7,917亿美元，同比大幅增长25.6%。

相较于全球芯片市场的周期性波动，中国始终是带动全球半导体市场增长的重要动力，市场需求保持稳健增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重持续提升。根据中国半导体行业协会（CSIA）的数据，2022年中国集成电路产业销售额为12,006亿元；2023年受全球消费电子需求疲软、终端厂商去库存影响，传统芯片需求被拉低，同时外部技术限制制约了高端芯片供应，产业增长动力相对不足，但中国集成电路产业销售额仍小幅增长至12,277亿元，同比增长2.3%；2024年AI算力、新能源汽车、工业互联网等新兴领域需求爆发，叠加国产替代加速推进、成熟制程产能持续释放，中国集成电路产业实现快速增长，全年销售额达14,313亿元，同比增长16.6%，增速显著高于全球平均水平。据WSTS的测算，2024年中国集成电路市场规模占全球市场的37%，2016-2024年复合增长率达14.63%，远超全球6.44%的增长率，2025-2030年中国集成电路行业市场规模将以8%左右的年均增长率扩张。

随着AI及汽车电子等新兴领域需求持续扩容、成熟制程芯片自给率提升带动国产化和政策扶持大基金等持续加码，中国市场得以持续快速增长。我国集成电路产业的持续快速发展，为国内电子元器件分销行业提供了广阔的市场空间，直接推动分销行业规模稳步扩大。

3) 芯片国产化带来的发展机遇

随着国民经济的快速发展,中国整体消费市场不断壮大,电子产业作为国民经济的支柱产业,受益于消费市场的整体提升,近年来处于快速发展阶段。

当前全球电子元器件产业重心持续向中国集聚,全球元器件生产巨头在中国境内设立工厂,积极开展生产、销售工作。中国本土原厂也随之快速崛起,诞生了一批优秀的元器件生产企业,如兆易创新、江波龙、摩尔线程等,部分原厂已在世界元器件竞争格局中占据了重要的地位。

从行业发展规律来看,原厂崛起必将带动分销行业同步发展。分销行业核心价值在于为原厂提供产品推广与供应链服务,语言文化相通、市场响应高效是本土分销的天然优势。艾睿电子、安富利及大联大控股的发展历程均印证了原厂与分销商协同成长的逻辑,随着大陆原厂快速崛起,本土分销商也迎来重要发展机遇。

(2) 影响行业发展的不利因素

1) 本土分销商体量有待提升

海外电子元器件分销商凭借靠近海外原厂资源的先天优势,经过多年的持续经营与大规模并购整合,已形成雄厚的资金实力、庞大的业务规模与广泛的全球布局,不仅代理产品线数量众多,产品应用领域覆盖全面,能够充分发挥规模效应与综合服务优势。

相比之下,我国本土电子元器件分销商发展时间相对较短,行业整体体量与海外头部企业仍存在一定差距,部分企业代理产品线及应用领域相对集中,在资金实力、全球化布局及综合竞争能力等方面,与海外成熟分销商相比仍处于相对不利的竞争地位。

2) 贸易摩擦冲击电子信息产业发展

全球贸易摩擦持续升级,我国电子信息产业承压前行。当下产业链格局中,电子元器件分销商的供需衔接、稳链保供价值愈发凸显,但行业整体遭受显著冲击。

目前我国高端电子元器件仍存技术短板,核心领域受制于人,本土原厂产品

难以匹配高端应用需求。若关键技术攻关与国产化突破进度滞后，将直接拖累产业整体发展。同时，海外严苛贸易管制持续加码，境内分销商若无法灵活适配政策变动、筑牢供应链安全壁垒，难以发挥保链稳链作用，便无法立足行业变局，实现长期稳健经营。

6、行业特有的经营模式、周期性、区域性和季节性特征

(1) 行业特有的经营模式

在电子元器件分销行业，分销商根据不同经营模式主要分为授权分销商、独立分销商、目录型分销商三种类型，公司目前的主要经营模式为授权分销商模式。

授权分销商与原厂合作密切，拥有原厂的授权，可以在原厂授权区域内销售其电子元器件产品。授权分销商与原厂信息交换充分，产品的交期、价格可以得到有效保证，部分授权分销商在原厂的协助下对产品进行应用端的开发，能够根据客户需求提供整体解决方案和技术支持。由于授权分销商稳定的供货渠道、价格优势，以及部分授权分销商强大的技术方案能力，授权分销商更有可能进入大客户的合格供应商体系，与大客户保持长期合作。

独立分销商作为授权分销商的补充，利用信息不对称，收集市场上的多余存货，并向存货短缺的客户销售，获取利润，平衡市场供需。独立分销商无须原厂授权、不受原厂销售区域等约束，在全球范围内，通过多种途径采购各种品牌和型号的电子器件产品，并且进行全球销售，其客户和服务模式呈现明显的多样性。

目录型分销商销售产品的品种、品牌、规格、型号齐全，并且日常维持一定量的库存，可以快速提供客户需要的任何电子元器件。对比授权分销商和独立分销商，目录型分销商更适用于小批量采购的客户，其客户较为分散，销售价格较高。

(2) 周期性

电子元器件分销行业不具有明显的周期性，其发展情况与经济发展状况有较高的相关性。近年来，随着国内经济的高速发展，国内电子元器件分销行业处于相对景气的发展阶段。

(3) 区域性

国内电子元器件分销企业及其分支机构主要集中在长三角、珠三角、京津冀以及香港地区。长三角、珠三角、京津冀地区为电子产品制造商的聚集区域，靠近下游客户有利于分销商开展业务；香港地区较为便利的贸易环境有利于分销商货物和资金的流转。

(4) 季节性

电子元器件分销行业不具有明显的季节性，但由于下半年为电子产品销售旺季，因此，电子元器件分销行业下半年的业绩会略好于上半年。

7、行业利润水平变动趋势及变动原因

电子元器件分销行业的利润水平通常处于一个较为稳定的区间，其利润水平主要受到是否提供技术服务、下游应用领域不同、下游客户规模的大小等因素的影响。

从技术服务角度看，对于同类产品，提供配套技术服务的分销商利润水平高于仅销售产品的分销商，提供系统级解决方案的分销商利润水平高于提供产品级技术支持的分销商。

从下游应用领域来看，主要服务于消费电子行业的分销商利润水平一般会低于主要服务于工业控制、汽车电子等领域的分销商。

从下游客户规模来看，对于同类市场和产品，向大客户销售产品的利润水平一般低于向小客户销售产品的利润水平。

8、行业与上下游行业之间的关联性及其对行业发展前景的影响

(1) 行业与上下游行业之间的关联性

电子元器件分销行业上游为电子元器件设计制造行业，下游为电子产品制造业。产业链下游应用领域广泛，企业数量众多，产业链上游技术壁垒较高，大中型设计制造企业相对较少，难以匹配下游多样化的需求，分销商作为连接上下游必不可少的纽带，协助上游原厂进行市场开拓，并对下游电子产品制造商提供技术支持、产品交付等服务。因此，作为上下游行业之间的纽带，本行业的发展与

上下游发展状况的关联性较强。

(2) 上下游行业发展状况

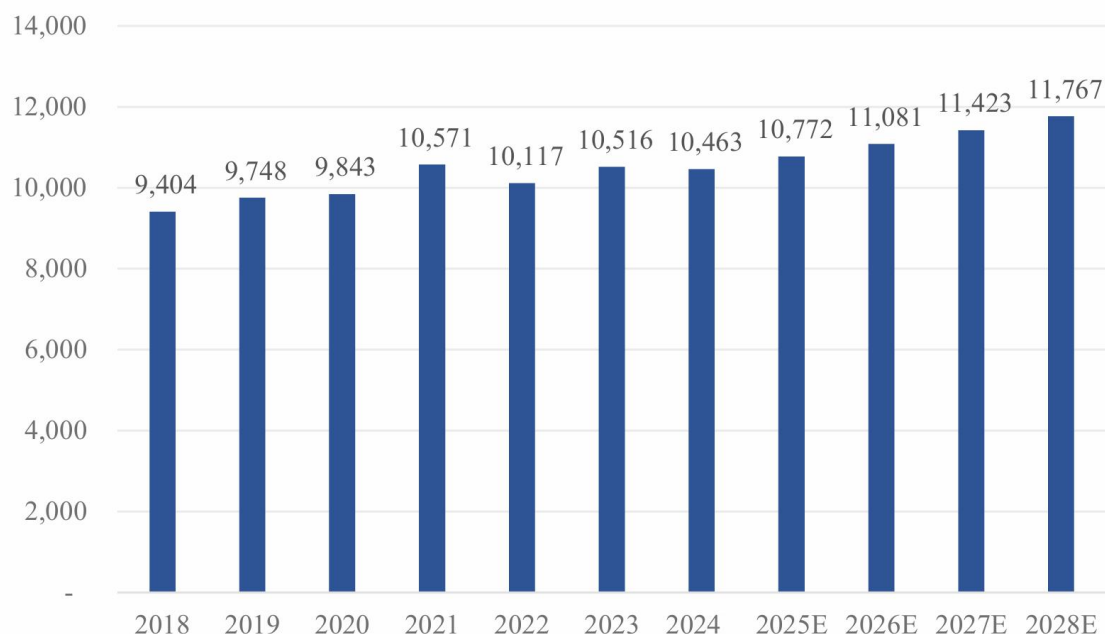
海外分销商跟随境外原厂的崛起而壮大，而国内分销商是随着国内下游电子产品制造业的发展而逐步成长起来的，下游应用领域的发展前景对国内分销商尤为重要。近年来上游本土半导体原厂的快速崛起与国产替代加速，进一步为国内分销商打开了成长空间。

1) 下游应用领域的发展前景

① 消费电子领域

消费电子主要是面向大众消费市场的电子整机产品，涵盖了智能手机、笔记本电脑、平板电脑以及 TWS 耳机、智能手环、智能眼镜等可穿戴电子设备等产品。近年来，人工智能、云计算、物联网、虚拟现实等新兴技术快速发展，带动消费电子产品快速迭代，为消费电子发展注入新的驱动力。从全球市场来看，根据 Statista 统计数据，2024 年全球消费电子市场规模约为 10,463 亿美元，预计 2028 年增长至 11,767 亿美元，2024-2028 年复合增长率达 2.98%，保持稳健增速。

2018-2028年全球消费电子行业市场规模及预测（亿美元）



数据来源：Statista

受全球宏观经济环境的影响，2022 年度消费电子市场规模出现下滑，但市

场总体需求仍然居于高位。长期来看，消费者对电子产品的需求长期存在，随着生产生活秩序的有序恢复，物联网、人工智能、VR、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，将会加速产品更新换代，催生新的产品形态，推动消费电子行业市场规模不断扩大，未来消费电子终端市场仍具有较大增长空间。

我国是全球领先的消费电子产品前沿市场，消费电子产销规模均居世界第一，近年来，国内消费电子产业持续扩张，多元化创新成果层出不穷，产业链、供应链现代化水平稳步提升，我国已成为消费电子产品全球重要的制造基地。根据 Statista 统计数据，2024 年中国消费电子市场规模约为 2,186 亿美元，预计 2028 年增长至 2,550 亿美元，2024-2028 年复合增长率达 3.93%，呈现稳定增长趋势。

公司持续在大消费电子市场深耕细作，为客户提供更多的产品品类和技术服务，保证了与核心客户长期稳定的合作。

②汽车电子领域

全球汽车产业正在进入升级与变革的关键阶段，新能源汽车相比燃油车具备鲜明的电动化、智能化和网联化特征，新能源汽车单车汽车电子设备量远高于燃油车，且带来了全新的充电基础设施需求，在新能源汽车浪潮推动下汽车电子已进入全新成长周期，成为汽车行业创新发展和各大整车厂商差异化竞争的核心要素，其产品价值量迅速提升。根据盖世汽车研究院统计，在混合动力汽车与纯电动汽车中汽车电子成本占比将提升至 47%-65%，相比传统各档次紧凑型汽车的 15%-28%大幅提升，新能源汽车的渗透率与销量提升将显著带动汽车电子市场的规模提升。

我国是目前全球最大也是增速最快的新能源汽车市场，根据中国汽车工业协会统计，2025 年，我国新能源汽车产销量分别为 1,662.6 万辆和 1,649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的 47.9%，较 2024 年提高了 7 个百分点。新能源汽车国内销量占汽车国内销量比例为 50.8%，成为我国汽车市场主导力量。2021 年 10 月国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》，提出“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比”。根据公安部数据，2025 年底国内汽车保有量达 3.66 亿辆。其中新能源汽车的保有量达到 4,397 万辆，约占汽车总量的 12.01%。我国新能源

汽车的渗透率与保有量仍有巨大的增长空间。

受益于新能源汽车的渗透率与销量提升,全球与我国汽车电子市场规模均持续增长。根据 Research Nester 的统计和预测,2025 年全球汽车电子市场规模为 2,955.1 亿美元,预计 2035 年达到 5,978.2 亿美元,年均复合增长率为 7.3%。

得益于公司前期的持续投入和产业布局,公司销售的产品包括 MCU、功率器件、电源类芯片等,产品也从传统的车载娱乐系统向车身、三电系统(电池、电控、电机)等应用场景覆盖,客户群体包括 Tier1 厂商和多家主流车企供应链,市场份额在不断扩大,报告期内汽车电子市场营收增长显著。

③工业控制领域

受益于我国制造业转型升级、智能制造全面推进以及新型工业化战略实施,工业控制行业呈现持续稳定增长态势,市场规模稳步扩大,发展前景广阔。根据赛迪顾问数据,2024 年中国工业控制系统市场规模达 3,160 亿元,同比增长 12.8%;据中国工控网《2024 年中国工业自动化市场白皮书》测算,2025 至 2030 年行业复合增速有望维持在 8%-10%,显著高于全球平均水平。

在政策支持、技术突破与下游需求多重驱动下,工业控制行业正迎来结构性机遇,国产替代成为行业最核心的发展主线之一。赛迪顾问数据显示,2024 年国内本土厂商在工控市场的份额已提升至 42.6%,随着工业 MCU、伺服驱动、传感器、工业通信等核心器件技术不断成熟,叠加供应链安全需求提升,国产化率仍具备较大提升空间,为行业内企业带来持续增长动力。同时,工业控制应用场景不断拓展,工业机器人、新能源与储能、光伏、轨道交通、高端装备制造等领域需求快速释放,边缘计算、工业互联网、5G、低功耗无线通信等技术 with 工控系统深度融合,推动行业向智能化、网络化、数字化方向升级,行业整体成长空间持续打开。

公司聚焦仪器仪表、HMI、PLC、伺服控制等细分场景,深度服务于工业控制下游客户,充分受益于行业规模扩张与国产替代进程,未来将依托行业发展红利实现相关业务的稳步增长。

④新能源领域

随着国家“双碳”目标深入推进、能源产业绿色转型提速以及新型能源体系

加快建设，新能源行业保持稳健高速增长，整体市场体量不断攀升，具备长期向好的发展前景。根据中国能源局统计数据，2024年我国新能源发电装机容量突破18亿千瓦，同比增长20.8%；据中国光伏行业协会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟联合测算，2025至2030年行业复合增速维持在12%至15%区间，增速领跑全球电子元器件应用市场。

在产业政策扶持、下游需求爆发与供应链自主可控的多重驱动下，新能源行业迎来黄金发展机遇，核心元器件国产替代成为行业主流趋势。赛迪顾问数据显示，2024年我国新能源领域本土电子元器件厂商份额提升至48.3%，随着光伏逆变器、储能BMS、车载电源、充电桩等核心部件技术逐步突破，叠加海外供应链不确定性加剧，国内新能源器件国产化率仍有大幅提升空间，为行业内优质企业带来充足的增长动能。同时，新能源应用场景持续拓宽，光伏、风电、储能、新能源汽车、充电桩、氢能装备等领域需求集中释放，大功率器件、智能控制、高效电源等技术与新能源设备深度融合，推动行业向高效化、智能化、轻量化方向升级，行业成长边界持续拓宽。

公司积极拓展光伏逆变、储能系统、数字电源等新能源下游客户，深化与国内头部厂商合作，抢抓新能源行业增长机遇。

⑤机器人领域

制造业用工成本攀升，产线自动化改造需求迫切，叠加新型工业化政策落地，工业机器人成为制造业升级的核心装备，行业规模持续稳步增长。根据MIR睿工业数据，2024年中国工业机器人市场规模达1,060亿元，同比增长15.2%；据中国工控网《2024年工业机器人市场白皮书》测算，2025至2030年行业复合增速维持在9%至12%区间，增速居于工业自动化细分领域前列。

随着运动控制、机器视觉、柔性驱动等核心技术持续迭代，工业机器人的精度、稳定性和适配性不断提升，逐步覆盖更多复杂生产场景，行业发展根基愈发稳固。工业机器人在汽车整车及零部件、3C电子、金属加工、新能源装备、仓储物流、轻工制造等领域的渗透率稳步提升，制造业自动化产线改造、智能工厂建设持续推进，带动下游市场需求稳步释放。同时，人机协作、多机协同、数字化运维等新技术的落地应用，进一步拓宽了机器人的使用边界，推动行业朝着高

电路领域的自给率较低，部分核心芯片产品严重依赖进口。根据我国海关总署数据，2025 年我国芯片进口金额高达 4,251.6 亿美元，贸易逆差达 2,227.5 亿美元，连续多年成为第一大进口商品。我国芯片整体自给率约 28% - 32.7%，其中 28nm 及以上成熟制程自给率达 60%，14nm 以下先进制程自给率不足 10%，国产替代呈现明显结构性分化，发展空间广阔。

(3) 上下游行业发展状况对本行业及其发展前景的影响

1) 下游新兴市场的兴起带动分销商的发展

电子元器件分销行业下游市场需求多元、前景良好。当前，5G-A、AIoT、低轨卫星通信、人工智能以及智能网联汽车等新技术加速渗透，其中物联网连接数突破 150 亿、智能网联汽车销量预计突破 8,000 万辆，持续催生庞大的半导体市场需求，电子元器件分销行业直接受益，已进入高质量增长的新一轮上升周期。随着新兴应用领域潜力持续释放，电子元器件分销行业将获得更为广阔的发展空间。

2) 上游市场的增长带动分销商的发展

为满足下游电子产品制造领域的新需求，上游电子元器件设计制造行业持续迭代升级，聚焦 5G-A、AIoT、智能网联汽车、卫星通信等新应用场景，设计、生产更具针对性的元器件产品。在新产品推广、技术落地及供应链配套方面，分销商凭借渠道优势、客户资源和技术服务能力大有可为，上游市场的持续增长的同时，也为分销行业的发展提供了稳定且广阔的空间。

3) 国产芯片的发展促进分销商的发展

随着芯片国产化持续深化，国产芯片已实现从“可用”向“好用”的跃迁。下游电子产品制造商基于成本控制、供应链安全保障及国产替代的刚性需求，对国产芯片的需求呈显著提升态势。一方面，下游厂商对新增中小型原厂及其产品的认知较为有限，分销商可依托自身品牌影响力、专业技术服务能力及丰富的客户资源，为该类原厂提供市场推广、客户对接等服务，促进产业链上下游高效协同，助力其快速开拓市场。另一方面，下游厂商需借助分销商开展芯片功能测试、应用方案开发，以及新原厂、新产品的评估与筛选工作，降低采购风险。产业链上下游对分销商的多元化需求，为其发展壮大提供了良好的市场契机。

本土原厂正加速拓展海外市场,本土分销商可依托自身渠道优势及本地化服务能力,在本土原厂海外市场开拓过程中,承担产品推广、供应链履约、售后支持等重要职能,迎来全新发展机遇。从行业发展规律来看,分销商的成长与本土原厂的崛起深度绑定:美国原厂的崛起催生了艾睿电子(Arrow)、安富利(Avnet)等美系分销商,中国台湾地区原厂的崛起催生了大联大、文晔等台系分销商,随着中国大陆地区芯片制造业的全面崛起,也将培育一批具备全球竞争力的本土分销商。

(二) 行业竞争情况

1、行业竞争格局

电子元器件分销行业是一个充分竞争的行业,本土电子元器件分销商是在竞争环境中逐渐成长起来的,不仅要与海外电子元器件分销商展开竞争,也要与其他本土电子元器件分销商展开竞争,同时,海外电子元器件分销商在中国市场也面临相互之间的竞争。

(1) 本土分销商与海外分销商的竞争格局

中国电子元器件分销行业已从分散竞争向集中化转型,头部效应日益凸显,面对中国电子元器件分销市场的发展机遇,本土分销商和海外分销商均基于各自的竞争优势和发展定位,在不同的专业领域内积极扩大业务规模,从而形成错位发展。

海外分销商以文晔科技、大联大、Arrow(艾睿电子)、Avnet(安富利)等全球性分销商为代表,其优势表现为多产品线、多产品种类、多应用领域、多销售区域,且头部企业已加速数字化转型,线上销售占比显著提升。而本土分销商对国内客户提供更加灵活的个性化服务,且依托本土原厂崛起和供应链本地化优势,能与海外分销商形成错位竞争。经过多年发展,中电港、香农芯创、泰科源、深圳华强等中国本土规模较大的分销商已具备与海外分销商正面竞争的实力。

此外,海外分销商随着其所在地原厂的强势崛起而成长壮大,而本土分销商则随着中国电子制造产业的发展、国产替代推进而快速成长。未来,随着本土原厂的快速成长,本土分销商由于背靠中国电子制造产业,将与本土原厂深度绑定、共同开拓市场,获取更大的竞争优势,与海外分销商的竞争将进一步加剧,竞争

焦点将转向技术服务、数字化能力与供应链整合效率。

(2) 本土分销商之间的竞争格局

根据《国际电子商情》，2024年中国本土分销商前25名的营业收入总和达2,470.34亿元，其中“百亿俱乐部”扩容至7家，前三名（中电港、泰科源、香农芯创）营收合计占前25名总和的43.5%，行业集中度显著提升，呈现“大者恒大”的发展态势。中国本土分销商大多起步于特定细分行业，经过多年发展，在各自领域形成相对竞争优势。其中，中电港、泰科源、香农芯创、深圳华强等本土分销商由于自身快速发展和兼并收购，规模相对较大，应用行业较广，在多行业形成激烈竞争。而在头部企业主导的格局下，细分领域专业化企业凭借技术壁垒与客户粘性，通过聚焦特定赛道实现突围。例如，香农芯创（300475.SZ）作为AI存储分销龙头，凭借“高性能AI芯片+存储”组合占据市场优势；雅创电子（300623.SZ）聚焦汽车电子元器件分销，受益于新能源汽车与智能驾驶的增长；商络电子（300975.SZ）核心代理村田、TDK等国际品牌，成为国内领先的被动元件分销商。

同时，行业内本土上市公司可以通过融资和并购扩大业务规模，在竞争中处于相对有利位置。电子元器件分销行业对资金的要求越来越高，本土分销商将通过不断进入资本市场或与资金实力雄厚的大型分销商合作或合并，借助资本的力量快速成长，巩固竞争优势。而中小分销商则面临资金、效率等多重压力，生存空间持续收缩。

(3) 海外分销商之间的竞争格局

2025年海外前四大电子元器件分销商文晔科技、大联大、Arrow（艾睿电子）、Avnet（安富利）的收入区间约为200亿美元-400亿美元，其中文晔超越艾睿电子跃居全球第一，头部企业规模优势显著，远超其他分销商。头部海外电子元器件分销商均拥有丰富的产品线资源，彼此之间产品线、客户群重合度较高，在全球范围内围绕大型客户、高毛利赛道（如AI、汽车电子）展开了激烈的竞争，其在中国市场的竞争情况也同样激烈，同时加速数字化转型以提升核心竞争力，进一步挤压中小海外分销商的市场空间。

2、行业内的主要企业

(1) 境外主要企业

①文晔科技

文晔科技股份有限公司成立于 1993 年 12 月，总部位于中国台北市。文晔科技为原厂及客户提供专业的电子元器件产品供应链管理服务，其代理的电子元器件产品主要应用于通讯、电脑及周边、消费电子、工业控制、物联网及汽车等应用领域。2025 财年，文晔科技的营业收入为 11,779.49 亿新台币（约合 380.11 亿美元）。

②大联大

大联大投资控股有限公司（股票代码：3702.TW）成立于 2005 年，总部位于中国台北市，2005 年在台湾证券交易所上市。大联大是提供产业供应链服务、需求制造、交钥匙解决方案、技术支持、仓储物流与电子商务等价值型服务的电子元器件分销商，满足原始设备制造商（OEM）、原始设计制造商（ODM）、电子制造服务商（EMS）及中小型企业等不同客户需求。2025 财年，大联大的营业收入达 9,991.24 亿新台币（约合 322.40 亿美元）。

③Arrow（艾睿电子）

Arrow Electronics, Inc.（股票代码：ARW.N）成立于 1946 年，总部位于纽约，1979 年在纽约证券交易所上市。Arrow（艾睿电子）是一家为工业和商业用户提供电子元器件和企业计算解决方案的全球供应商，核心服务领域包括工业供应链、汽车、医疗、消费电子、数据中心等。2025 财年，Arrow（艾睿电子）的营业收入为 308.53 亿美元。

④Avnet（安富利）

Avnet, Inc.（股票代码：AVT.O）成立于 1921 年，总部位于纽约，1960 年在纽约证券交易所上市。Avnet（安富利）是一家提供全球技术解决方案的电子元器件分销商，在产品生命周期的每个阶段为客户提供设计、产品、营销和供应链专业支持，致力于提供智能解决方案，减少将电子产品推向全球市场的时间、成本和复杂性。2025 财年，Avnet（安富利）的营业收入为 231.51 亿美元。

(2) 境内主要企业

①中电港

深圳中电港技术股份有限公司（股票代码：001287）成立于 2014 年 9 月，总部位于广东省深圳市，2023 年 4 月在深交所上市。中电港是行业领先的元器件应用创新与现代供应链综合服务平台，提供设计链服务、元器件分销、供应链协同配套和产业数据服务等综合解决方案。2025 年度，中电港的营业收入为 655.25 亿元。

②泰科源

泰科源控股有限公司成立于 1999 年。主要从事电子元器件的代理，为客户提供优质产品与一站式供应链服务，产品涵盖手机/消费类电子、汽车电子、智能家居及穿戴设备、物联网、人工智能、大数据、云存储等市场。2024 年度，泰科源的营业收入为 345.67 亿元。

③香农芯创

香农芯创科技股份有限公司（股票代码：300475.SZ）成立于 1998 年 9 月，总部位于安徽省宣城市，2015 年 6 月在深交所上市。公司以半导体分销为核心，同时布局企业级存储产品自主研发，形成“分销+自研”双轮驱动，主营存储芯片、算力芯片等半导体元器件分销，并开展企业级存储产品研发生产，深度服务 AI 算力、云计算、服务器等领域。2025 年度，香农芯创的营业收入为 352.51 亿元。

④深圳华强

深圳华强实业股份有限公司（股票代码：000062.SZ）成立于 1994 年 1 月，总部位于广东省深圳市，1997 年 1 月在深交所上市，深圳华强是国内领先的电子元器件分销与产业服务平台，面向电子信息产业链提供线上线下交易服务、产品服务、技术服务、交易信息服务和创新创业配套服务。2025 年度，深圳华强的营业收入为 249.09 亿元。

⑤商络电子

南京商络电子股份有限公司（股票代码：300975.SZ）成立于 1999 年 8 月，

总部位于南京市，2021年4月在深交所上市。该公司主要分销被动电子元器件、主动及其他电子元器件等产品，面向汽车电子、工业控制、网络通信、消费电子等领域提供供应链服务。2025年度，商络电子营业收入为85.48亿元。

⑥雅创电子

上海雅创电子集团股份有限公司（股票代码：301099.SZ）成立于2008年1月，总部位于上海市，2021年11月在深交所上市。该公司主要分销汽车电子元器件（含光电器件、存储芯片、被动元件和分立半导体等产品），并开展车规级电源管理IC的自主研发设计业务。2025年度，雅创电子营业收入为66.12亿元。

⑦英唐智控

深圳市英唐智能控制股份有限公司（股票代码：300131.SZ）成立于2001年7月，总部位于广东省深圳市，2010年10月在深交所创业板上市，英唐智控是国内知名的电子元器件综合分销与半导体IDM企业，以电子元器件分销为基础、芯片设计制造为核心，为消费电子、汽车电子、工业控制、通信等领域客户提供元器件供应、技术支持及整体解决方案。2025年度，英唐智控的营业收入为55.86亿元。

⑧润欣科技

上海润欣科技股份有限公司（股票代码：300493.SZ）成立于2000年10月，总部位于上海市，2015年12月在深交所上市，润欣科技是国内领先的IC产品授权分销商及解决方案提供商，专注于无线通信IC、射频IC及传感器件的分销、应用设计与技术服务，产品广泛应用于移动通讯、物联网、汽车电子、消费电子等领域。2025年度，润欣科技的营业收入为28.88亿元。

四、主要业务模式、产品或服务的主要内容

（一）主要产品及其用途

1、主营业务概况

公司是国内知名的电子元器件分销商，主要向消费电子、汽车电子、工业控制、新能源、机器人和通讯及数据中心等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。公司代理的产品主要包括

交付、款项支付等五个主要环节，公司对采购业务全流程进行动态监测和管理。

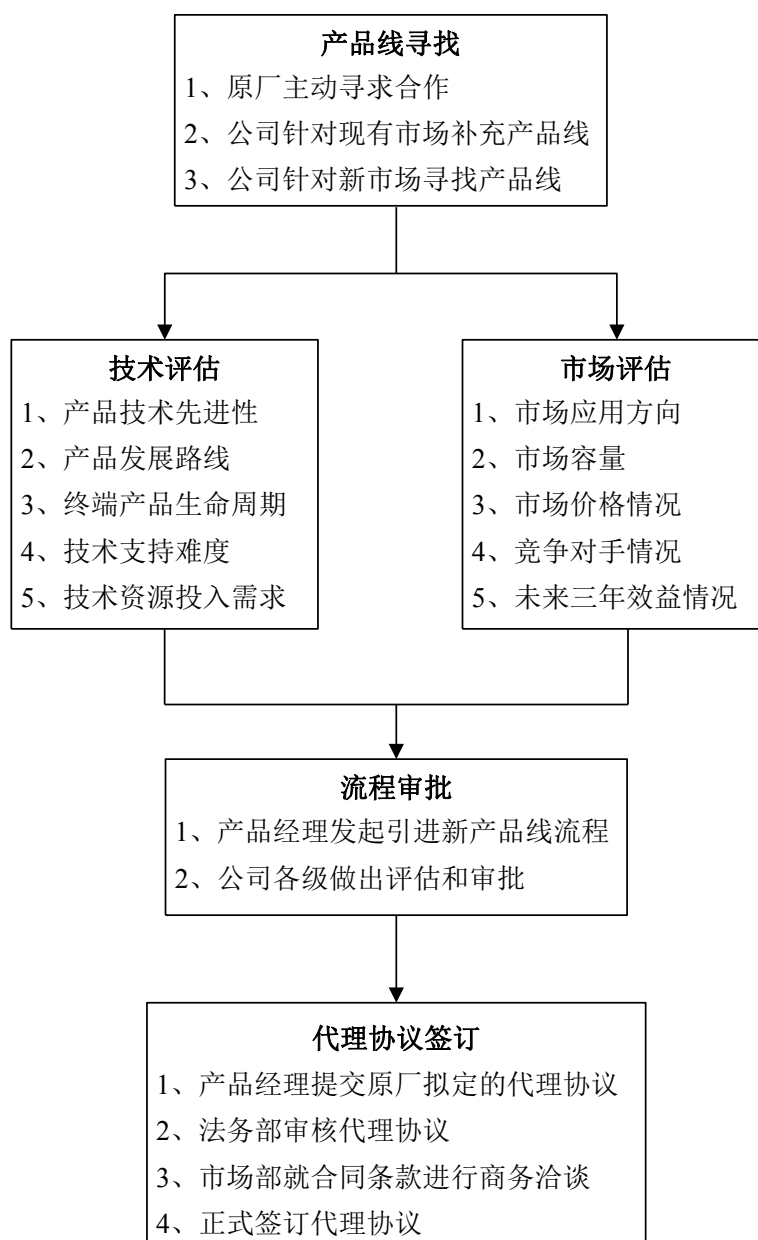
1) 产品线引入阶段

①产品线的引入

产品线引入包括产品线寻找、技术评估、市场评估、流程评审、代理协议签订等五个主要步骤。

公司获得新产品线授权的主要方式包括原厂主动寻求合作、公司针对现有市场补充产品线、公司针对新市场寻找产品线。在与相关原厂进行初步接洽后，公司对产品技术先进性、产品发展路线、终端产品生命周期、技术支持难度、技术资源投入需求等进行技术评估分析；对市场应用方向、市场容量、市场价格情况、竞争对手情况、未来三年效益情况等因素进行市场评估分析。基于对技术、市场两个方面的综合评估，公司内部通过严格的审批，最终与原厂签订代理协议，取得该产品线的代理资质。

产品线引入流程如下图所示：



②产品线管理

公司会定期评估所有代理产品线的市场效益。针对综合效益较好的产品线，公司会加大投入力度，巩固已有优势，扩大销售规模；针对综合效益下降明显的产品线，公司将评估其产品竞争力以及公司投入资源情况，如果是产品竞争力不足，公司将逐步减少该产品采购量，如果是公司资源投入不足，公司将继续加大投入力度；针对新产品线或新领域，公司一般会给予三年的投入期，在投入期公司放宽对其市场收益的要求，与原厂共同开拓市场，挖掘市场潜力。

2) 采购业务流程

公司业务支持部负责统筹各子公司的电子元器件采购信息,监督采购执行情况;各子公司严格按照内控制度实施对外采购,并将采购信息及时反馈至公司业务支持部。

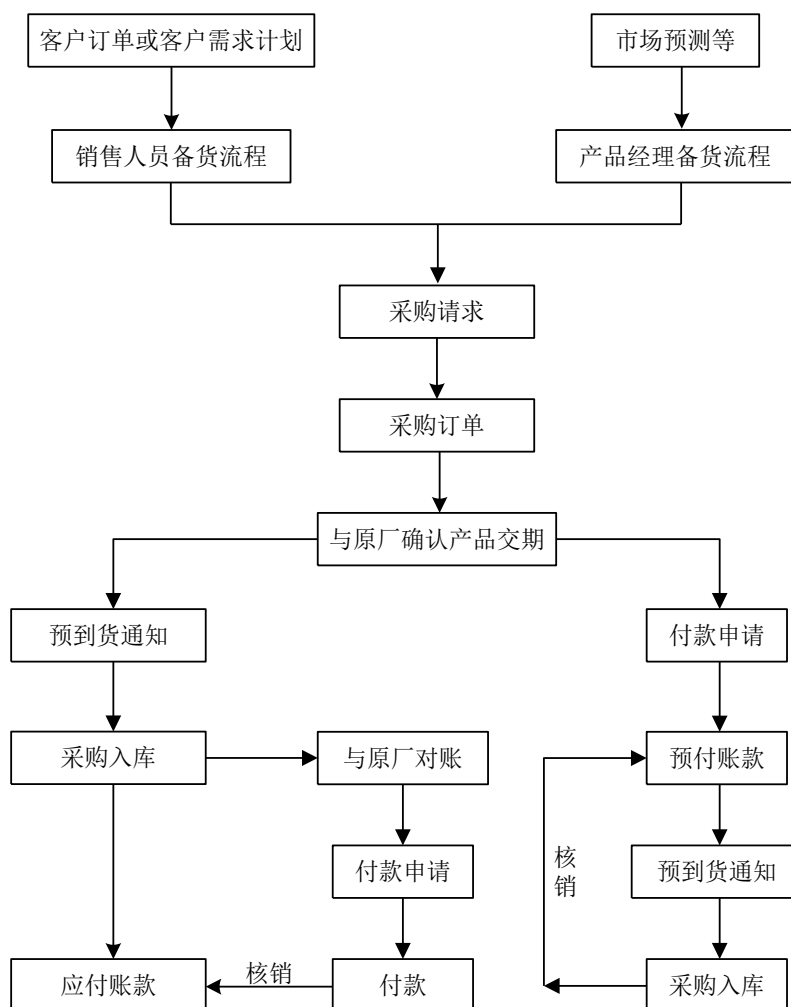
公司根据销售订单量、客户提供的需求计划、公司对市场需求的预计情况,综合制定备货计划。一方面,公司主要备货由销售人员在收到客户订单或客户需求计划后,发起备货申请。另一方面,公司其他备货由产品经理发起,产品经理根据成熟产品线的一部分通用型物料对应以往出货记录及市场预计需求情况,判断销售人员备货不足时,进行适量备货,同时对新产品线在推广阶段的产品需求也会进行适量备货。

订单下达和产品交付事项由业务支持部与原厂接洽。销售人员和产品经理提出的采购请求经公司各级审批完成后归档至公司业务支持部,由业务支持部进行汇总、向原厂下单、确认产品交期、调整产品交期与数量、跟进原厂产品交付情况等事宜。

一般情况下,业务支持部收到原厂发货通知后,向仓储部门发出预到货通知,仓储部门做好收货准备,最终签收并入库。业务支持部在货物入库之后与原厂对账,并向财务部门提交付款申请,财务部门根据业务支持部的付款申请及货款账期情况向原厂付款。

此外,部分采购存在预付货款的情况,业务支持部与原厂确认产品交期后即向财务部门提交付款申请,财务部门根据业务支持部的付款申请向原厂预付货款,原厂收到货款后安排发货,业务支持部收到原厂发货通知后,向仓储部门发出预到货通知,仓储部门做好收货准备,最终签收并入库。

具体采购流程如下：



(2) 销售模式

公司电子元器件分销业务主要是向消费电子、汽车电子、工业控制、新能源、机器人和通讯及数据中心等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件，并提供产品方案和技术支持。销售业务流程主要包括市场开发策略和技术支持策略的制定、向潜在客户提供技术支持方案 and 产品销售四个环节。

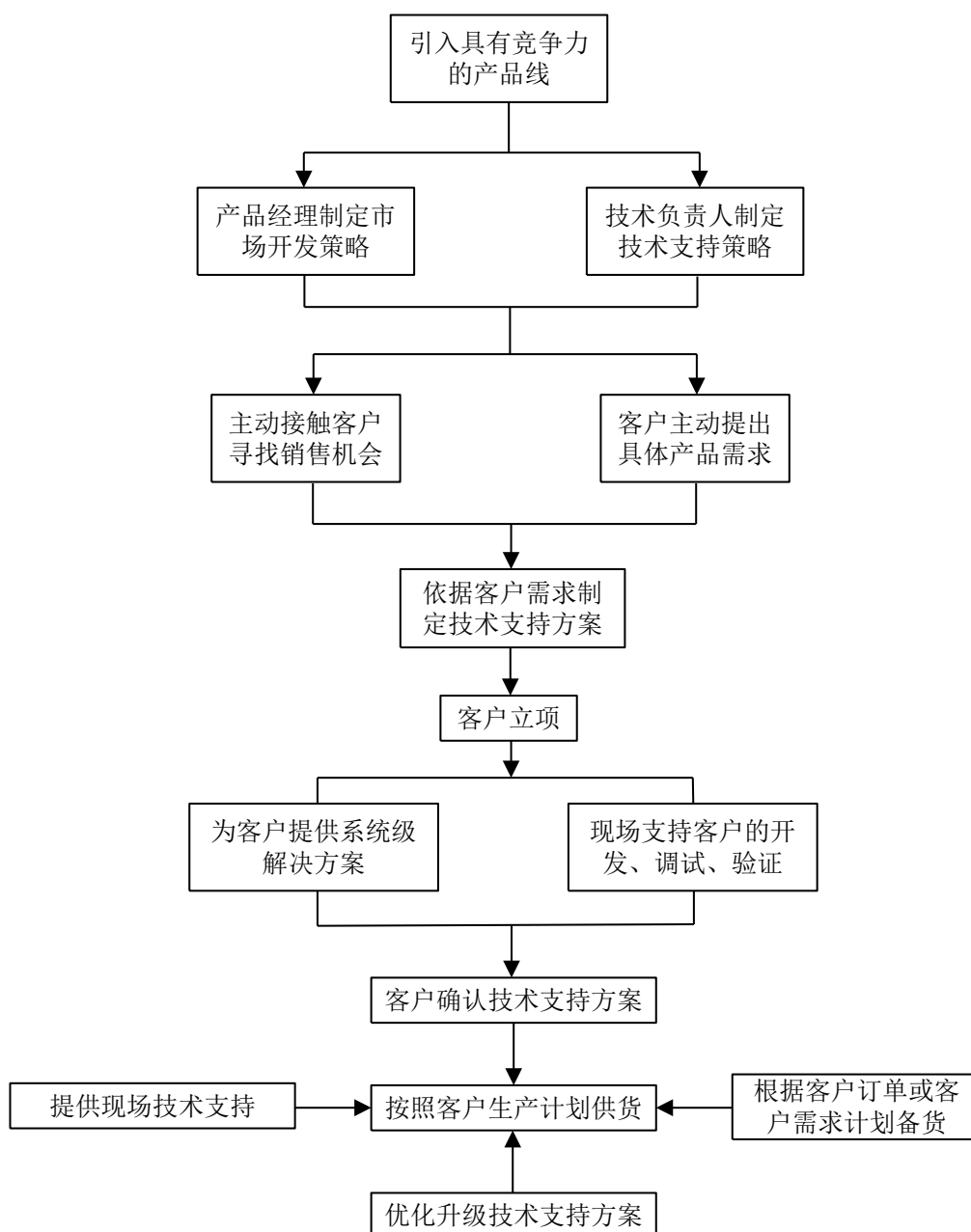
在公司引入具有竞争力的产品线之后，公司从市场和技术两个方面对新产品线进行分析，产品经理制定市场开发策略，技术负责人制定技术支持策略。

完成产品策略制定后，一方面，公司主动接触客户寻找销售机会；另一方面，客户主动提出具体产品需求。在双方接洽并确定合作后，客户立项，公司根据客户需求提供整体解决方案，并现场支持客户的开发、调试、验证等工作。公司根

据客户订单或需求计划备货，按照客户生产计划交付产品，提供技术支持，并不断优化升级技术支持方案。

上述销售方式为典型的完整流程销售，并非公司所有销售业务都要经过上述的所有环节，部分销售业务通过部分环节就可以完成销售。

公司分销业务中心对公司的销售活动统一管理、制定年度业务计划，各下属子公司在分销业务中心的统一管理下独立与客户签订合同并开展业务活动。公司销售业务流程如下：



公司分销业务在销售过程中经常会向客户提供技术服务，技术服务一般不直

数字化转型,升级供应链管理、客户管理与仓储物流系统,提升运营精细化水平与整体工作效率,压缩非必要运营成本,通过内部管理升级释放经营活力。同时全力开拓五大高景气新兴市场,精准对接赛道内优质客户资源,持续引进高价值产品线,深化与原厂及核心客户的战略合作,稳步扩大业务覆盖范围与市场渗透率,推动业务规模与盈利水平同步提升,稳步实现经营业绩持续稳健增长。

2、探索产业链并购整合,实现外延式增长

立足公司整体战略布局与产业链完善需求,秉持审慎稳健、风险可控的原则,持续关注产业链上下游优质标的,重点围绕核心技术补齐、渠道资源拓展、产品线完善等方向,积极探索产业链并购、战略投资等外延式发展路径。通过整合行业优质资源,弥补现有业务短板,强化业务协同效应,进一步完善产业链上下游布局,打破自身发展边界,借助资本运作实现外延式扩张增长,快速提升综合竞争力与行业地位,培育新的业绩增长点。

3、加大技术研发投入,强化创新赋能

持续加大技术研发资金与专业人才投入,保障研发资源稳定供给,聚焦星闪技术、边缘计算、汽车电子核心方案、AI终端应用等行业前沿领域,开展核心技术攻关与应用方案研发。完善技术人才梯队培养体系,深化与高校、科研机构及头部原厂的产学研协同合作,加速自主技术方案、核心板卡与定制化服务成果转化,加快各类技术方案落地应用,以技术创新全面赋能分销主业转型升级,持续巩固技术型分销商核心优势,提升业务附加值与市场竞争力。

4、健全内控管理体系,筑牢合规经营防线

健全完善全流程内部控制与风险防控体系,严格遵守国家法律法规、行业监管要求及资本市场规则,强化全员合规经营意识,将合规理念融入业务全环节。全面梳理排查供应链波动、市场变动、财务管控等各类经营风险,建立风险识别、预警与应急处置机制,规范业务开展、资金管理、决策执行等全流程操作,定期开展内控自查与优化整改,堵塞管理漏洞,筑牢合规经营与风险防控防线,保障公司各项业务规范有序、平稳运营,为长期可持续高质量发展夯实管理基础。

(三) 募集资金投向与未来发展目标的关系

发行人主要从事电子元器件分销业务。本次向特定对象发行股票的募集资金

长的原因及合理性。

公司于 2025 年 6 月 17 日收到深交所《关于对深圳市好上好信息科技股份有限公司 2024 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2025〕第 601 号），对公司营收增长但净利润连续三年大幅下滑、经营活动现金流持续为负且大幅净流出、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备计提、前五大供应商采购集中度、预付款项、境外资产、交易性金融资产等方面进行了问询。发行人结合电子元器件分销行业趋势、下游需求变化、产品销售结构、毛利率变动、期间费用增长、同行业可比公司经营情况，详细说明业绩波动与现金流承压的原因及合理性；结合应收账款账龄结构、期后回款、历史坏账损失率、同行业计提政策，说明坏账准备计提的充分性与审慎性；结合存货库龄、可变现净值、周转情况、同行业对比，说明存货跌价准备计提依据及新增计提的合理性；结合行业采购特性、上游原厂集中度、同行业对比，说明采购集中度高的原因及不存在重大依赖；结合预付款项交易背景、商业实质，说明不存在资金占用与财务资助；说明境外子公司经营与财务状况及会计师审计程序；说明交易性金融资产具体内容、划分依据及相关审议与信息披露程序。

第二节 本次证券发行概要

一、本次发行的背景和目的

(一) 本次向特定对象发行股票的背景

1、国家产业政策持续赋能，支持半导体产业链高质量发展

近年来，国家持续提升半导体行业战略地位，相关部委及地方政府出台多项产业政策，推动产业链结构调整与升级，为电子元器件分销行业发展营造了良好政策环境，亦为公司本次募投项目实施提供了坚实支撑。

2024年1月，工业和信息化部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，以材料突破、技术攻关和生态构建为核心，推动半导体产业链向高端化、自主化升级，通过国产替代与技术创新提升全球竞争力。2024年7月，中共中央发布《关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，提出健全集成电路等重点产业链自主可控能力，全链条推进技术攻关与成果应用，明确半导体作为数字经济底层硬件支撑，需求将随智能制造、物联网等领域拓展持续增长。2025年9月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》，将集成电路列为重点领域，提出16项举措促进产业转型升级、强化产业链韧性。2025年10月发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，将集成电路关键核心技术全链条攻关提升至国家科技安全战略高度。

国家政策大力推动半导体产能扩张与市场需求增长，驱动产品迭代升级，带动电子元器件分销行业规模持续提升，为公司建设智能仓储物流中心、补充业务发展资金提供了良好的外部政策。

2、下游新兴赛道需求集中释放，电子元器件分销市场规模稳步扩容

近年来，人工智能、新能源汽车、5G通信、工业自动化等下游领域快速发展，持续拉动电子元器件需求增长，推动分销市场规模稳步扩容。据世界半导体贸易统计组织（WSTS）数据，2025年全球半导体销售额达7,917亿美元，同比增长25.6%，核心电子元器件市场规模达1.6万亿美元。

国内市场方面，工信部数据显示2023年我国电子元件市场规模达2.78万亿

中国证监会的同意注册。

在获得深交所的审核通过以及中国证监会的同意注册后,发行人将向深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股票发行和上市事宜,完成本次向特定对象发行股票全部呈报批准程序。

2、技术储备

自成立以来，公司始终坚持以技术为驱动，以技术服务为差异化竞争策略，以客户芯片应用需求和下游行业发展方向为导向，结合代理产品特性构建了针对性强、成熟度高的技术服务体系。凭借在 IC 分销行业的长期深耕，公司积累了覆盖物联网、智能汽车、工业控制等多领域的解决方案库和行业经验，形成自主核心技术，对产业链需求及发展动向具备深刻理解和前瞻性判断，可精准匹配合上游产品技术与下游客户需求，为新项目产品的技术适配与市场拓展提供有力支持。经过多年积累，公司技术优势显著，截至 2025 年 12 月 31 日，公司及下属子公司拥有专利 94 项（其中发明专利 9 项）、集成电路布图设计权 2 项，芯片应用端的技术服务能力得到充分验证。

3、市场储备

公司凭借丰富的产品品类与优质的服务能力，公司已与小米集团、四川长虹、康冠股份、兆驰股份、华曦达等知名电子产品制造商建立长期稳定的合作关系，同时赢得众多中小客户的持续信赖，形成覆盖头部客户与中小客户的多元化优质客户体系。公司主要客户在各自细分领域发展态势良好，未来增长潜力充足。

公司始终关注优秀的国内电子元器件厂商的成长和发展需求，利用公司优秀的技术服务能力和优质的下游客户资源，帮助国内 IC 厂商产品快速应用和拓展更为广泛的应用领域，已与星辰科技（Sigmastar）、恒玄科技（BES）、江波龙（Longsys）、圣邦股份（SGMC）等国内知名电子元器件厂商建立了较为深入且紧密的合作关系，为抓住日益加快的国产化进程，公司将进一步扩大在国产芯片产品线上的投入，以提高行业地位。

综上，公司本次募集资金投资项目均围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

（二）资金缺口的解决方式

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入的募集资金总额，在最终确定的本次募投项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决

本次募集资金投资项目实施完成后,公司将提高仓储物流的运行效率和管理能力,统筹管理仓储资源,以便满足业务及客户快速增长的需求;有利于补充公司营运资金,支持公司业务快速发展带来的资金需求。项目的建成有助于公司提升市场竞争地位,增强核心竞争力和抗风险能力。

综上,本次募集资金主要投向主业,本次募投项目的建设具有必要性和合理性。

六、募集资金用于研发投入的情况

本次募集资金不存在用于研发投入的情况。

七、募集资金投向产生的同业竞争及关联交易

本次募集资金投向完成后,公司不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生新的关联交易。

八、募投项目实施后对公司经营的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次发行股票募集资金用途符合公司经营发展需要,募集资金的使用有助于解决公司业务发展过程中对资金的需求,进一步推动公司主营业务的发展,落实公司发展战略,进而提高公司核心竞争力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后,公司的资本实力进一步增强。公司的总资产和净资产规模均会相应增长,现金流状况和财务状况将进一步改善,抗风险能力和后续融资能力将得到提升,将为公司后续发展提供有力保障。

本次发行完成后,公司股本总额将即时增加,但募集资金投资项目在短期内无法即时产生效益,因此,公司的每股收益短期内存在被摊薄的风险。但从长远来看,随着募集资金投资项目预期效益的实现,公司的盈利能力将会进一步增强。本次募集资金投资项目的实施有利于提高公司的主营收入与利润规模,提升公司综合实力和核心竞争力。

九、募集资金专项管理制度

发行人已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规范性文件的规定，制定了《深圳市好上好信息科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投向的管理和监督进行了明确的规定。

公司根据相关法律法规制定了《募集资金管理制度》，对本次募集资金将按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关要求采用专户存储制度，募集资金存放于专户中并遵守专款专用的规定。

十、募投项目新增固定资产及无形资产的影响

“智能仓储物流中心项目”的投资总额为13,007.95万元，建设完成后公司预计新增固定资产11,060.69万元，新增无形资产358.49万元，由此将导致每年固定资产折旧及无形资产摊销的增长。

短期内，折旧摊销费用的增加可能会对发行人的经营业绩有所影响，但长期来看为公司业务规模的进一步扩大奠定坚实的仓储物流基础，有利于公司快速的发展，不会对公司未来经营业绩造成重大不利影响。

万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金净额：74,690.79						已累计使用募集资金总额：69,358.45				
变更用途的募集资金总额：15,575.65						各年度使用募集资金总额：69,358.45				
						2025 年：654.35				
变更用途的募集资金总额比例：20.85%						2024 年：10,600.10				
						2023 年：46,296.53				
						2022 年：11,807.47				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	扩充分销产品线项目	扩充分销产品线项目	46,924.20	46,924.20	46,372.37	46,924.20	46,924.20	46,372.37	-551.83	2025 年 10 月
2	总部及研发中心建设项目（注）	总部及研发中心建设项目	10,821.90	1,396.10	1,408.38	10,821.90	1,396.10	1,408.38	12.28	2024 年 10 月
3	物联网无线模组与智能家居产品设计与制造项目	物联网无线模组与智能家居产品设计与制造项目	7,177.47	7,177.47	1,914.26	7,177.47	7,177.47	1,914.26	-5,263.21	2026 年 10 月
4	补充流动资金项目	补充流动资金项目	9,767.22	9,767.22	9,826.67	9,767.22	9,767.22	9,826.67	59.45	不适用
5		永久补充流动资金（注）		9,794.55	9,836.77		9,794.55	9,836.77	42.22	不适用
合计			74,690.79	75,059.54	69,358.45	74,690.79	75,059.54	69,358.45	-5,701.09	

注 1：公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“总部及研发中心建设项目”，并将相应剩余募集资金

金 9,794.55 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司将前述募集资金专户剩余的募集资金共计 9,836.77 万元已全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。

注 2：“扩充分销产品线项目”、“总部及研发中心建设项目”、“补充流动资产项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额部分系现金管理收益和孳息净额（已扣除银行手续费等）；“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异原因主要系项目尚未结项。

（二）前次募集资金实际投资项目变更、延期情况

公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，于2024年10月14日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止“总部及研发中心建设项目”，并将相应剩余募集资金9,794.55万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。2024年11月6日，公司已办理完成募集资金专户注销手续，并将前述募集资金专户剩余的募集资金共计9,836.77万元全部转入公司一般账户用于永久性补充流动资金。

公司于2025年8月26日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》，同意公司变更“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”募集资金用途，调整该项目内部投资结构并予以延期至2026年10月31日。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因详见本节“二、前次募集资金的实际使用情况”之“(一)前次募集资金使用情况对照表”相关内容。

（四）前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（五）前次募集资金项目先期投入及置换情况

公司前次募集资金项目不存在先期投入及置换情况。

（六）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审

议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。2025 年 4 月 21 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金 6,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时公司及时将该资金归还至募集资金专户。2025 年 9 月 25 日，公司提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金 1,500 万元至募集资金专项账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金 4,500.00 万元。

(七) 闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 11 月 2 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币 2

亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。

公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

公司于2024年9月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,使用额度不超过人民币1亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,闲置募集资金在前述额度和期限范围内可滚动使用,到期后将及时归还至募集资金专户。公司董事会授权公司及子公司法定代表人及其授权人士签署上述现金管理事项相关的各项法律文件。

公司于2025年9月26日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》,同意公司及子公司在不影响募投项目正常实施进度的情况下,以将首次公开发行股票并上市募集资金的存款余额以协定存款方式存放,期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司董事会授权公司及子公司法定代表人签署上述协定存款事项相关的各项法律文件。

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期赎回,除暂时补充流动资金4,500.00万元外,尚未使用的募集资金均以协定存款方式存放募集资金专户中。

(八) 剩余募集资金的使用计划和安排

截至2025年12月31日,公司尚未使用募集资金余额5,433.74万元,其中

以活期（含协定存款）方式存放于募集资金专项账户的金额为 933.74 万元，暂时补充流动资金 4,500.00 万元。公司尚未使用募集资金占募集资金总额 6.41%，该部分剩余募集资金将根据项目进度陆续投入。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	扩充分销产品线项目	不适用 (注 1)	至达产年，公司将新增营业收入 140,543.25 万元，项目税后财务净现值为 19,091.74 万元；税后内部收益率为 29.01%，项目税后静态回收期为 5.63 年	2,578.69	-112.16	-21.24	2,445.29	不适用 (注 2)
2	总部及研发中心建设项目	不适用 (注 1)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目	不适用 (注 1)	至达产年，可实现年营业收入 18,174.78 万元。项目税后财务净现值为 4,625.78 万元；税后内部收益率为 26.45%，项目税后静态回收期为 5.46 年	66.10	-95.89	90.18	60.39	不适用 (注 2)
4	补充流动资金项目	不适用 (注 1)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比，以上募集资金所投资的项目均不适用产能利用率。

注 2：“扩充分销产品线项目”、“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”尚未至达产年，故不适用是否达到预计效益。

上表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

1、“总部及研发中心建设项目”实施后将进一步完善公司软硬件研发设施，不会产生直接的经济效益，无法单独核算效益。

2、“补充流动资金项目”有利于进一步推进公司主营业务的发展，该项目不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益情况

“扩充分销产品线项目”、“物联网无线模组与智能家居产品设计及制造项目”尚未至达产年，故不适用是否达到预计效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容不存在差异。

六、会计师对前次募集资金使用情况的鉴证结论

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况进行了鉴证，并于 2026 年 3 月 30 日出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（司农专字[2026]25009740015 号），鉴证结论为：好上好董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，如实反映了好上好截至 2025 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合公司未来发展战略布局和行业发展趋势。本次发行完成后，发行人主营业务保持不变，不涉及对现有业务及资产的整合，不会对业务及资产产生重大影响。

二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

截至本募集说明书签署之日，公司实际控制人为王玉成、范理南夫妇，二者控制公司表决权的比例为 39.5694%。假设本次向特定对象发行按照发行数量上限 86,502,805 股发行，且发行人实际控制人不参与认购，则本次发行完成后王玉成、范理南夫妇控制公司表决权的比例为 32.9745%，仍为公司实际控制人，因此本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化，不适用《注册管理办法》第八十七条的规定。

三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况

截至本募集说明书签署之日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，发行人是否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况

截至本募集说明书签署之日，本次向特定对象发行股票尚未确定发行对象，发行人是否与发行对象或发行对象的控股股东、实际控制人存在关联交易的情况，将在发行结束后公告的发行情况报告中予以披露。

第六节 与本次发行相关的风险因素

一、产品代理授权被取消或不能续约的风险

原厂的授权是电子元器件分销商稳健发展的基石,电子元器件分销商的市场拓展是原厂延伸销售的重要途径。公司拥有联发科(MTK)、星宸科技(Sigmastar)、移远(Quectel)、达发(Airoha)、德明利、格科微(Galaxycore)、江波龙(Longsys)、恒玄科技(BES)、PI(帕沃英蒂格盛)、Nordic(北欧半导体)、Cirrus Logic(凌云半导体)、圣邦微(SGMC)、矽力杰(Silergy)、兆易创新(GD)等为代表的一系列全球及国内半导体行业知名原厂分销授权,稳定交易的产品线数量超过100条。如果未来因原厂自身业务调整、公司的服务支持能力无法满足原厂的要求,或是公司与原厂出现争议或纠纷等原因导致公司无法持续取得新增产品线授权或已有产品线授权被取消,这将对公司的业务经营造成重大不利影响。

二、供应商集中的风险

公司电子元器件分销业务采购产品为电子元器件。报告期各期,公司向前五大供应商采购金额占采购总额的比例分别为64.07%、54.90%和47.66%,前五大供应商采购金额占比较高。如果公司前五大供应商的经营状况、产品质量出现问题,或公司与前五大供应商的合作关系发生不利变化,前五大供应商不能向公司持续供应电子元器件产品,则可能对公司的电子元器件分销业务以及经营业绩产生重大不利影响。

三、上下游合作模式变化风险

经过多年的行业演变,原厂、电子元器件分销商、电子产品制造商三者形成了共生关系。一方面,对于下游电子产品制造商而言,电子元器件集成度越来越高,如果其针对每一款电子元器件均直接进行应用端的研发,则将带来高昂的研发成本,但若其在原厂或电子元器件分销商提供的技术方案的基础上进一步研发,则能降低研发投入,并能缩短项目研发周期。另一方面,对于原厂而言,其优势在于电子元器件的设计与开发,除少量大型客户外,其余客户的开发、维护更多依赖于分销商以降低成本。此外,对于分销商而言,其同时代理大量产品线,具

备对单一客户提供多品类产品的能力，其单位服务成本较低。

未来，如果原厂扩大直接服务下游电子产品制造商的范围、原厂与主要客户选择其他分销商替代发行人的角色、主要客户引入替代产品及供应渠道或出现其他导致上下游合作模式发生不利于分销商的变化情况，则作为电子元器件分销商，公司现有分销业务及经营业绩将受到重大不利影响。

四、宏观经济波动风险

电子元器件是电子工业与信息设备的核心基础，公司主要向消费电子、汽车电子、工业控制、新能源、机器人和通讯及数据中心等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件。若未来国内外宏观经济环境恶化，相关行业需求下降，将可能会导致公司出现客户需求下降、电子元器件库存上升、资金压力加大等情况，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。

五、行业竞争加剧的风险

目前，国内电子元器件分销行业市场集中度较低，处于相对分散的市场格局，价格竞争可能导致行业整体利润空间承压；受限于资金、人员、资源以及海外分销商强势竞争等因素，国内分销商规模相对较小，抗风险能力相对较弱。公司面临国内外同行业企业的激烈竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实力，以巩固公司在行业中的优势竞争地位，可能导致公司面临市场占有率降低，盈利能力下降的风险。

六、新产品推广、开发风险

发行人的主营业务包括电子元器件分销业务、物联网产品设计及制造业务以及芯片定制业务，其中电子元器件分销业务涉及新产品推广，物联网产品设计及制造业务以及芯片定制业务涉及新产品开发，新产品的推广、开发需耗用大量的人力和物力。若发行人新产品推广或开发不力，不能及时准确把握市场需求情况，将导致发行人推广或开发的产品不能得到市场的认可，这将可能对发行人经营业绩产生重大不利影响。

七、核心人员流失、核心技术泄漏风险

发行人多年来持续针对原厂的芯片产品开展应用端的方案设计和技术开发，

参与下游客户的终端产品方案开发,经过多年的研发和积累,发行人在芯片产品的应用端形成了多项较为成熟的技术,并将这些技术应用于发行人的整体解决方案设计。由于主动元器件分销业务对发行人的技术服务能力有一定的要求,这一部分很大程度上依赖专业人才,特别是核心技术人员,如果出现核心技术人员流失的情况,不仅会影响发行人为下游客户提供芯片应用端服务能力和持续创新能力,还有可能导致方案技术的泄密,对发行人经营业绩造成重大不利影响。

八、电子元器件分销业务毛利率变动的风险

报告期内,公司电子元器件分销业务的毛利率分别为4.53%、4.03%和4.48%,毛利率水平相对较低,该情形主要与产品应用领域、产品结构、市场供求情况以及下游销售价格、上游采购成本变化等因素有关。如果未来公司电子元器件产品下游应用领域、产品结构、市场供求情况以及下游销售价格、上游采购成本发生重大不利变化,则可能导致公司电子元器件分销业务的毛利率进一步下降,进而影响公司的盈利能力。

九、经营活动现金流量为负的风险

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,815.91万元、-37,979.07万元和-39,590.25万元,报告期内连续为负数。在公司的电子元器件分销业务中,供应商的货款账期短于客户的货款账期,公司对供应商的付款早于公司对客户的收款,付款与收款之间存在时间差异,同时在公司电子元器件分销业务规模扩大的过程中,容易出现资金缺口,导致经营活动产生的现金流量净额为负数的情形。如果未来公司与客户、供应商之间的信用政策发生重大不利变化,或者公司的融资渠道发生重大不利变化,则可能导致公司的现金流出现风险,进而影响公司的持续经营能力。

十、存货减值风险

考虑到上游原厂电子元器件的生产供应周期往往与下游客户的生产需求周期不匹配,公司需提前向原厂采购、备货并进行库存管理,导致公司存货规模较大,2023-2025年末,公司存货账面价值分别为61,374.15万元、59,265.42万元和77,812.62万元,占同期末资产总额的比列分别为23.08%、21.21%和19.53%。如果未来出现公司未能及时应对上下游行业供需变化或其他难以预料的原因导

致存货无法顺利实现销售,且存货价值低于可变现净值,则该部分存货需要计提存货跌价准备甚至最终出现大额损失,这将对公司经营业绩产生重大不利影响。

十一、应收账款回收风险

随着公司未来对市场的进一步开拓及销售规模的扩大,公司的应收账款金额及应收账款占总资产的比例可能将有所增长,2023-2025年末,公司应收账款账面价值分别为104,148.67万元、156,160.95万元和220,241.47万元,占同期末资产总额的比列分别为39.16%、55.87%和55.29%。应收账款的增长可能导致公司应收账款坏账准备计提金额增加,从而对公司经营业绩产生不利影响。此外,如果公司出现大量应收账款无法收回的情况,也将对公司经营业绩及现金流造成重大不利影响。

十二、预付款项金额持续上升的风险

2023年末、2024年末及2025年末,公司预付款项余额分别为3,826.22万元、10,655.04万元和15,406.37万元,呈持续上升趋势,主要系报告期内公司经营规模持续扩大,预付采购货款随之相应扩大所致。若未来公司主要预付款项对应的供应商若出现经营恶化、资金链断裂、停产、破产、失信、涉诉被执行等情形,可能导致无法供货、延迟供货、交付质量不达标,预付款项难以收回,从而对公司经营业绩产生不利影响。

十三、汇率波动风险

公司在日常经营活动过程中涉及的外汇收支业务主要包括香港子公司向原厂支付美元计价的产品采购款、香港子公司向客户收取以美元计价的产品销售款和香港子公司向内地子公司收取以人民币计价的产品销售款,香港子公司以港币作为记账本位币,容易受到美元对港币以及人民币对港币汇率波动的影响。若未来美元对港币和人民币对港币汇率波动较大,则公司可能会产生汇兑损失,进而导致公司利润下滑,这将会对公司经营业绩造成不利影响。

十四、国际贸易纷争风险

公司从境外采购的电子元器件产品的金额占公司电子元器件采购总额的比例较高,近年来,由于国际贸易环境的恶化,相关国家挑起了与中国的贸易纷争,

该等贸易纷争对公司的正常生产经营活动造成了一定的负面影响。若未来相关贸易纷争加剧,则公司可能面临无法或者无法以合理价格从相关国家和地区进口元器件的风险,从而对公司的生产经营带来严重的负面影响。

十五、审批风险

本次向特定对象发行 A 股股票方案已经公司董事会和股东会审议通过,尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册,最终能否发行成功及发行时间均存在不确定性。

十六、募集资金无法募足的风险

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15,627.95 万元(含本数),发行对象由股东会授权董事会在获得中国证监会注册批复后,根据申购报价的情况,遵照价格优先等原则合理确定。如因经济环境变化、证券市场波动、公司股票价格走势等因素导致询价过程无有效申购报价或认购不足等情形,本次发行募集资金将面临无法全额募足的风险。

十七、募集资金投资项目实施效果偏离预期的风险

公司本次募集资金主要用于“智能仓储物流中心项目”,该项目的实施将提升公司仓储物流环节的智能化水平,优化公司供应链效率,从而增强公司的核心竞争力。若届时市场需求出现较大不利变化,或因管理经验不足导致公司不能充分发挥仓储物流优势,则可能导致公司面临募集资金投资项目实施效果偏离预期的风险。

十八、固定资产折旧增加导致利润下滑的风险

本次募集资金投资项目建成后,公司固定资产规模将对应增加。随着公司固定资产规模的扩大,公司仓储物流能力将有效增强,电子元器件分销业务的服务水平及销售规模将得到提升。但是,若市场环境出现不利变化,公司存在固定资产折旧增加导致利润下滑的风险。

十九、经营管理风险

随着项目的逐步推进,公司人员逐渐壮大,产品线种类增加,仓储规模扩大,

管理难度将加大, 现有管理体系可能难以适应经营规模扩大的要求。如果公司管理体系不能及时调整完善, 将对项目实施带来不利影响。

二十、股价波动风险

本次发行将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响, 公司基本面情况的变化将会影响股票价格。另外, 国家宏观政策和经济形势、重大政策、行业环境、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格, 给投资者带来风险。公司提醒投资者, 关注股价波动的风险。

二十一、净资产收益率和每股收益摊薄的风险

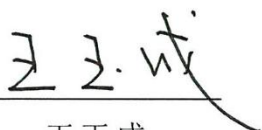
本次向特定对象发行股票后, 公司的股本及净资产均有所增长。**若公司业务规模和净利润未能获得相应幅度的增长**, 则本次发行完成后预计公司当年每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标可能会出现一定程度的下降, 将导致公司即期回报会出现一定程度摊薄的风险。

第七节 与本次发行相关的声明

发行人及全体董事、高级管理人员声明

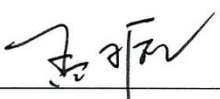
本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：


王玉成

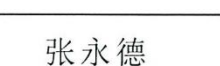

范理南

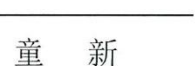

王丽春

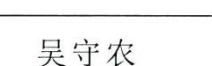

孟振江


尚高明

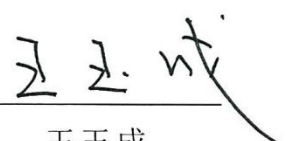

夏世勋


张永德

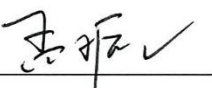

童新


吴守农

全体高级管理人员签名：


王玉成


王丽春


孟振江

深圳市好上好信息科技股份有限公司



2026 年 6 月 14 日

第七节 与本次发行相关的声明

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 王玉成	_____ 范理南	_____ 王丽春
_____ 孟振江	_____ 尚高明	_____ 夏世勋
 _____ 张永德	_____ 童 新	_____ 吴守农

全体高级管理人员签名：

_____ 王玉成	_____ 王丽春	_____ 孟振江
--------------	--------------	--------------

深圳市好上好信息科技股份有限公司




2026 年 6 月 14 日

第七节 与本次发行相关的声明

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

_____ 王玉成	_____ 范理南	_____ 王丽春
_____ 孟振江	_____ 尚高明	_____ 夏世勋
_____ 张永德	 _____ 童 新	_____ 吴守农

全体高级管理人员签名：

_____ 王玉成	_____ 王丽春	_____ 孟振江
--------------	--------------	--------------

深圳市好上好信息科技股份有限公司

2026 年 6 月 14 日

第七节 与本次发行相关的声明

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

王玉成

范理南

王丽春

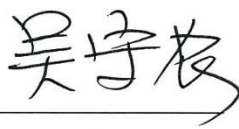
孟振江

尚高明

夏世勋

张永德

童 新


吴守农

全体高级管理人员签名：

王玉成

王丽春

孟振江

深圳市好上好信息科技股份有限公司



2026 年 6 月 14 日

董事会审计委员会声明

本公司董事会审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事会审计委员会成员签名：



张永德

董 新

吴守农

深圳市好上好信息科技股份有限公司



2026 年 6 月 14 日

董事会审计委员会声明

本公司董事会审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事会审计委员会成员签名：

张永德



童 新

吴守农

深圳市好上好信息科技股份有限公司



2026 年 6 月 14 日

董事会审计委员会声明

本公司董事会审计委员会承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。


全体董事会审计委员会成员签名：

张永德

童 新



吴守农


深圳市好上好信息科技股份有限公司


2026 年 6 月 14 日

发行人控股股东声明

本单位承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东  热点投资有限公司

董事：

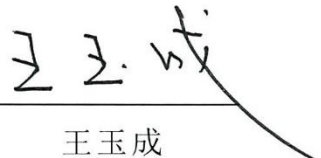

王玉成

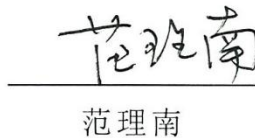
2026 年 6 月 14 日

发行人实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实际控制人：


王玉成


范理南

2026 年 6 月 14 日

保荐人（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人：

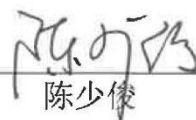


瞿楠

保荐代表人：



蔡其龙



陈少俊

法定代表人：



张纳沙

国信证券股份有限公司

2026年6月14日

保荐人（主承销商）董事长、总经理声明

本人已认真阅读深圳市好上好信息科技股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理：


邓 舸

董事长：


张纳沙

国信证券股份有限公司


2026年6月14日

发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书,确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议,确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

负责人: 
张学兵

经办律师: 
周江昊

经办律师: 
黄超颖



会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告及内部控制审计报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



吉争雄

签字注册会计师：



签字注册会计师：



伍绮莉

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）



2020年6月14日

发行人董事会声明

（一）除本次发行外，未来十二个月内是否存在其他股权融资计划

除本次发行外，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。若未来公司根据业务发展需要及资产负债状况需安排股权融资时，将按照相关法律法规履行相关审议程序和信息披露义务。

（二）董事会对本次发行摊薄即期回报的承诺并兑现填补回报的具体措施

为有效防范本次向特定对象发行股票可能带来的即期回报被摊薄的风险，公司拟采取以下具体措施，提升公司经营效率和募集资金的使用效率，实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报。

1、加强募集资金管理，确保募集资金使用合法合规

为保障公司规范、有效使用募集资金，公司将根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行专户存储、使用、管理和监督。本次向特定对象发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的用途、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用。

2、积极落实募集资金投资项目，提升公司持续盈利能力

本次募集资金投资项目经过审慎、充分的论证，并获得公司董事会批准，符合公司发展战略。本次募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，有利于进一步提升运营效率、增强综合竞争力并提升盈利能力。本次募集资金到位后，公司将进一步加快推进募投项目的建设和实施，推动公司的效益提升，实现并维护股东的长远利益。

3、完善公司治理，加强经营效率，提供制度保障和提升经营业绩

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，持续完善内控制度建设，为公司发展提供制度保障。此外，

公司将不断完善业务发展模式，拓展下游应用领域推动业务规模增长，加强日常经营管理效率，降低运营成本，进一步巩固和提升市场地位和竞争能力，全面提升经营业绩。

4、完善利润分配制度，优化投资者回报机制

公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司法》和《公司章程》的规定，制定了未来三年（2026年—2028年）股东回报规划，对公司利润分配、未来分红回报规划作出了明确规定，充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利，完善了董事会、股东会对公司利润分配事项的决策程序和机制。本次向特定对象发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

公司提醒投资者，以上填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（三）公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东热点投资有限公司、实际控制人王玉成作出如下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、若违反上述承诺，本单位/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构指定或发布的有关规定、规则，对本单位/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定作出如下承诺：

“1、本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，

本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；

3、本人将严格遵守相关法律法规、中国证监会和证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事、高级管理人员行为规范的要求，不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；

4、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现；

5、本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会和股东会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

6、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东会审议该员工股权激励议案时投赞成票（如有投票/表决权）；

7、若本人违反上述承诺，将在股东会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。”

（本页无正文，为深圳市好上好信息科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书《发行人董事会声明》之盖章页）

深圳市好上好信息科技股份有限公司
董事会

A red circular stamp is positioned over the company name and 'Board of Directors' text. The stamp contains the company name '深圳市好上好信息科技股份有限公司' around the top edge, the characters '董事会' (Board of Directors) in the center, and a unique identification number '4403066176826' at the bottom.

2026 年 6 月 14 日